

股票简称：精智达

股票代码：688627



深圳精智达技术股份有限公司

2026 年度向特定对象发行 A 股股票

募集说明书

(注册稿)

保荐人（主承销商）



中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

声 明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。

一、本次向特定对象发行股票情况

1、本次向特定对象发行股票方案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议、2026 年第一次临时股东会、第四届董事会第十五次会议、第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会第十六次会议、第四届董事会审计委员第十次会议审议通过，本次发行方案**已获得**上海证券交易所审核通过，**尚需**中国证监会同意注册后方可实施。

2、本次发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会做出予以注册决定后，根据询价结果与保荐人（主承销商）协商确定。若发行时国家法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

3、本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。

本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进

行相应调整。

最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，由股东会授权公司董事会或董事会授权人士和保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。

4、本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 28,238,446 股（含本数）。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会做出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

5、本次发行完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象基于本次发行所取得的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易还需遵守《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

6、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 285,658.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称		拟投资总额	拟使用募集资金投资金额
1	半导体存储测试设备研发及产业化智造项目	半导体存储测试设备产业化智造项目	44,096.00	39,468.00
		半导体存储测试设备技术研发项目	38,124.00	38,100.00
	小计		82,220.00	77,568.00
2	高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目		158,800.00	153,800.00
3	补充流动资金		54,290.00	54,290.00
合计			295,310.00	285,658.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

7、本次向特定对象发行股票不会导致公司实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

8、本次向特定对象发行股票完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有。

9、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司制定了本次发行后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

公司所制定的填补回报措施不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成承诺，不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资

决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

二、重大风险提示

本公司特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”有关内容。其中，特别提醒投资者应注意以下主要风险：

（一）募投项目无法顺利实施的风险

本次募投项目是基于公司产品技术研发能力、行业技术发展趋势、国家产业政策等综合因素决定，募投项目经过了慎重、充分的可行性研究论证。若公司本次募投项目的技术研发方向不能顺应市场需求变化趋势、行业技术发展趋势发生重大变化、产品技术水平无法满足客户要求，公司将面临本次募投项目无法取得预期效果的风险。

（二）募投项目新增产能消化风险

公司本次募投项目的成功实施将显著提升公司半导体测试设备的研发、生产能力，可更好满足下游客户日益增长的产品需求。然而，如果未来半导体行业政策发生重大不利变化以及半导体设备下游市场增长、客户拓展及销售增幅等不及预期，将对募集资金的使用和回报产生不利的影响，出现新增产能难以消化及募投项目短期内无法盈利的风险。

（三）关于募集资金投资项目用地尚未取得的风险

截至本募集说明书签署日，发行人已竞得本次募投项目半导体存储测试设备研发及产业化智造项目用地并签署了《成交确认书》（深土交成〔2026〕35号），正在与土地出让机构签订国有土地出让合同。如公司不能及时取得相关土地使用权，将导致募集资金投资项目面临施工进度延后的风险。

（四）技术开发及升级迭代风险

报告期内，公司持续保持了高强度的研发投入。若在后续研发过程中关键技术未能突破、产品性能指标未达预期，新开发的产品和解决方案不能契合市场和客户需求，或者公司在研发方向上未能正确做出判断、未能及时准确地把握行业发展趋势和市场需求而进行相应的技术开发及升级迭代，将会产生研发失败、无法及时响应下游行业的新需求以及前期的研发投入难以收回的风险，进而会对公

司的经营情况和市场竞争力造成不利影响。

（五）技术人员流失的风险

公司所处行业具有典型的知识密集型、技术密集型特点，技术人员是公司生存和发展的重要基石。如果公司无法持续提供具有竞争力的薪酬待遇、研发条件以及发展平台，公司将难以吸引更多的关键技术人才，甚至可能出现关键技术人才流失的情形，对公司产品研发造成不利影响。

（六）客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五大客户实现营业收入分别为 57,622.50 万元、59,329.04 万元和 105,127.81 万元，占当期营业收入的比重分别为 88.85%、73.87%和 93.19%，集中度相对较高，主要原因为下游客户呈现数量少、规模大的特征。若公司主要客户生产经营情况出现不利变化或公司与客户合作关系发生变化，则可能对公司经营业绩产生不利影响。

（七）应收账款坏账风险

报告期末，公司应收账款及合同资产账面价值分别为 56,657.61 万元和 2,613.50 万元，共计占公司流动资产比例为 32.22%。如果宏观经济形势恶化或客户自身经营状况发生重大不利变化，则可能导致公司应收账款不能按期收回或无法收回的情况，进而将给公司业绩带来不利影响。

（八）市场竞争加剧风险

公司主营业务所在市场的主要参与者不仅包括占据主导地位的国际知名龙头企业，还有部分具有一定竞争力的国内企业。如果公司不能及时将现有的市场地位和核心技术转化为更多的市场份额，则可能会在维持和拓展客户过程中面临激烈的市场竞争，从而对公司的盈利能力带来不利影响。

目 录

声 明.....	1
重大事项提示	2
一、本次向特定对象发行股票情况.....	2
二、重大风险提示.....	5
目 录.....	7
释 义.....	10
一、一般释义.....	10
二、专业释义.....	11
第一节 发行人基本情况	13
一、发行人基本情况.....	13
二、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况.....	13
三、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况.....	14
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容.....	23
五、现有业务发展安排及未来发展战略.....	29
六、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况.....	30
七、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施.....	32
第二节 本次证券发行概要	34
一、本次发行的背景和目的.....	34
二、发行对象及其与公司的关系.....	38
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期.....	39
四、募集资金投向.....	40
五、本次发行是否构成关联交易.....	41
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化.....	41
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	41
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	42
一、本次募集资金使用计划.....	42
二、本次募集资金投资项目的的基本情况.....	42

三、项目实施的必要性和可行性.....	48
四、募投项目效益测算的假设条件及主要计算过程.....	57
五、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性.....	59
六、募集资金用于研发投入的情况.....	60
七、募集资金用于补充流动资金的情况.....	60
八、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务.....	64
九、本次发行满足“两符合”和不涉及“四重大”	65
十、本次发行符合“理性融资、合理确定融资规模”规定.....	66
十一、公司具有轻资产、高研发投入的特点.....	66
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	68
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划.....	68
二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化.....	68
三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况.....	68
四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况.....	68
五、本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化.....	68
第五节 历次募集资金运用	70
一、最近五年内募集资金基本情况.....	70
二、前次募集资金使用情况.....	71
三、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用.....	76
四、会计师事务所对前次募集资金所出具的专项报告结论.....	76
第六节 与本次发行相关的风险因素	78
一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素.....	78
二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素.....	79
三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素.....	80
第七节 与本次发行相关的声明	82

一、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明.....	82
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....	85
三、保荐人（主承销商）声明.....	86
四、发行人律师声明.....	88
五、审计机构声明.....	89
六、董事会声明.....	90

释 义

本募集说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有如下涵义：

一、一般释义

精智达、发行人、公司、本公司	指	深圳精智达技术股份有限公司
股票、A股	指	公司本次发行的人民币普通股股票
本次向特定对象发行股票、本次向特定对象发行、本次发行	指	深圳精智达技术股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票的行为
发行方案	指	深圳精智达技术股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案
定价基准日	指	计算发行底价的基准日
董事会	指	深圳精智达技术股份有限公司董事会
股东会	指	深圳精智达技术股份有限公司股东会
《公司章程》	指	《深圳精智达技术股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《证券期货法律适用意见第18号》	指	《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2023年度、2024年度、2025年度
最近三年	指	2023年度、2024年度、2025年度
报告期各期末	指	2023年末、2024年末、2025年末
深圳精智达半导体	指	深圳精智达半导体技术有限公司
合肥精智达	指	合肥精智达半导体技术有限公司
南京精智达	指	南京精智达技术有限公司
香港精智达	指	精智达（香港）有限公司
长沙精智达	指	长沙精智达电子技术有限公司
苏州精智达	指	苏州精智达智能装备技术有限公司

精智达集成电路	指	合肥精智达集成电路技术有限公司
精智达智能装备	指	合肥精智达智能装备有限公司
深圳萃通	指	深圳市萃通投资合伙企业（有限合伙）
中小企业基金	指	深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
南山架桥投资	指	深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）
源创力清源	指	深圳源创力清源创业投资合伙企业（有限合伙）
深圳丰利莱	指	深圳市丰利莱投资合伙企业（有限合伙）
深圳睿通达	指	深圳市睿通达投资合伙企业（有限合伙）
珠海冠中	指	珠海冠中集创科技有限公司
深圳高铂	指	深圳高铂科技有限公司
保荐人、主承销商、 国泰海通	指	国泰海通证券股份有限公司
发行人律师、国枫律 师、国枫	指	北京国枫律师事务所
审计机构	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）

二、专业释义

SEMI	指	Semiconductor Equipment and Materials International，半导体设备材料产业协会
AI	指	Artificial Intelligence，人工智能
HPC	指	High Performance Computing，高性能计算
HBM	指	High Bandwidth Memory，一种新的高带宽、大容量、低功耗的存储器结构
Micro OLED	指	Micro Organic Light-Emitting Diode，微米有机发光二极管
Micro LED	指	Micro Light-Emitting Diode，微米发光二极管
XR	指	扩展现实（Extended Reality），包括AR（增强现实）、VR（虚拟现实）、MR（混合现实）等技术的统称
AR	指	Augmented Reality，增强现实
VR	指	Virtual Reality，虚拟现实
MEMS	指	Micro-Electro-Mechanical System，微机电系统，利用集成电路及微加工技术把微结构、微传感器、微执行器等制造在一块或者多块芯片上的微型集成系统
分选机	指	封装测试环节的设备，用于对测试后的芯片进行筛选、分拣，按性能等级分类。
2.5D封装	指	先进封装技术之一，在基板上堆叠芯片和无源器件，通过中介层实现互连，提升集成度和性能
3D封装	指	多层芯片垂直堆叠封装技术，通过硅通孔（TSV）实现层间互

		连，显著提升芯片密度和性能
Chiplet	指	芯粒，一种先进封装技术，通过集成多个小芯片（Die）提升芯片性能，降低制造成本。
ASIC	指	Application Specific Integrated Circuit，专用集成电路
FPGA	指	Field Programmable Gate Array，现场可编程门阵列
DRAM	指	Dynamic Random Access Memory，动态随机存取存储器
CP	指	Chip Probing，半导体晶圆测试
FT	指	Final Test，半导体成品测试

本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

发行人的基本情况如下：

中文名称	深圳精智达技术股份有限公司
英文名称	Shenzhen SEICHI Technologies Co., Ltd.
法定代表人	张滨
股票上市地	上海证券交易所
股票简称	精智达
股票代码	688627
上市时间	2023 年 7 月 18 日
总股本	9,412.82 万股
公司住所	深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司 1 号 101 工业园 D 栋 1 楼东
邮政编码	518110
电话号码	0755-21058357
传真号码	/
公司网址	www.seichitech.com
电子信箱	jzd@seichitech.com
经营范围	一般经营项目是：自动化检测技术、机器视觉技术、智能机器人技术的研发；电容触摸屏自动化检测设备、机电一体化生产设备、机器视觉相关产品、智能机器人相关产品的研发、销售；计算机软件的技术开发及销售、技术咨询；自动化相关模组和器件、自动化生产技术咨询；国内贸易，经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：电容触摸屏自动化检测设备、机电一体化生产设备、机器视觉相关产品、智能机器人相关产品的生产。

二、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况

（一）发行人前十名股东的持股情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	张滨	17,474,715	18.59%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
2	香港中央结算有限公司	3,451,058	3.67%
3	中信银行股份有限公司－永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金	2,600,000	2.77%
4	深圳萃通	2,410,040	2.56%
5	中小企业基金	2,054,355	2.19%
6	南山架桥投资	2,000,000	2.13%
7	招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	1,877,092	2.00%
8	源创力清源	1,813,246	1.93%
9	深圳丰利莱	1,775,311	1.89%
10	深圳睿通达	1,625,000	1.73%
合计		37,080,817	39.44%

（二）发行人控股股东、实际控制人情况

截至 2025 年 12 月 31 日，张滨直接持有公司 18.59%股份，并通过深圳萃通及深圳丰利莱间接控制公司 4.45%的股份，合计控制公司 23.04%的股份，为公司控股股东、实际控制人。

三、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况

（一）公司所处行业及依据

公司聚焦半导体测试及新型显示器件检测领域，致力于为行业客户提供测试检测设备及系统解决方案。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年修订），公司属于专用设备制造业（行业代码：C35）；根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“新一代信息技术产业”中的“电子核心产业”下的“新型电子元器件及设备制造”（行业代码：1.2.1）。

（二）行业监管体制和主要政策及法律法规

1、行业主管部门、行业监管机制

公司所处行业的宏观管理职能由国家发改委、工信部、科技部承担，负责制定产业政策、技术改造指导、项目审批等，具体如下：

主管部门	主要职能
国家发改委	拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责国家级专项规划、区域规划、空间规划与国家发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关法律法规草案，制定部门规章等。
工信部	研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内工业、通信业和信息化固定资产投资等项目等。
科技部	拟订国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。牵头建立统一的国家科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制等。

2、行业主要法律法规政策及对发行人经营发展的影响

半导体及新型显示器件是支撑我国信息产业持续发展的战略性新兴产业，产业链长，对上下游产业带动性强，辐射范围广，对产业结构提升、经济增长方式转变都具有重要意义。近年来国家出台一系列鼓励扶持政策，为其高质量发展提供坚实支撑，具体如下：

序号	时间	发文部门	法律法规及政策	主要内容
1	2026 年 3 月	中共中央	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	聚焦战略必争领域和产业链供应链薄弱环节，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。
2	2025 年 8 月	工信部、市监总局	《电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案》	坚定不移推动“国货国用”，持续推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链……强化计算等领域芯片、零部件、整机系统等研发应用和配套适配。
3	2024 年 7 月	中国共产党二十届三中全会	《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》	抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。
4	2024 年 1 月	工信部等七部门	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	创新标志性产品：新型显示：加快量子点显示、全息显示等研究，突破 Micro-LED、激光、印刷等显示技术并实现规模化应用。
5	2023 年 2 月	工信部等七部门	《智能检测装备产业发展行动计划（2023—2025 年）》	供给能力提升重点方向：关于电子行业方面，突破电性能测试系统、高精度探针台等。
6	2023 年 12 月	国家发改委	《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	将球栅阵列封装（BGA）、插针网格阵列封装（PGA）、芯片规模封装（CSP）、多芯片封装（MCM）、栅格阵列封装

序号	时间	发文部门	法律法规及政策	主要内容
				(LGA)、系统级封装(SIP)、倒装封装(FC)、晶圆级封装(WLP)、传感器封装(MEMS)、2.5D、3D 等一种或多种技术集成的先进封装与测试,集成电路装备及关键零部件制造列为鼓励类产业
7	2021 年 12 月	财政部等五部门	《国家支持发展的重大技术装备和产品目录(2021 年修订)》	集成电路自动化测试及分选设备属于国家支持发展的重大技术装备和产品。

公司持续深耕半导体测试检测设备行业,以实现关键设备自主可控为核心目标,围绕核心业务持续延伸、拓展基于 AI 技术发展的系统化全站点服务能力。国家陆续出台的相关产业政策,充分凸显了公司所属行业在国民经济中的重要地位,各项政策的密集发布与落地实施,为公司业务发展营造良好经营环境,并提供坚实有力的政策支撑。

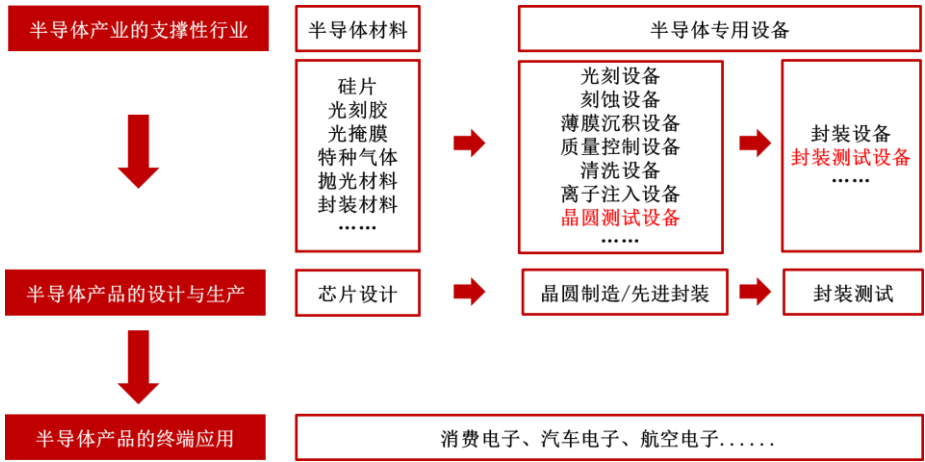
(三) 行业发展现状和发展趋势

公司聚焦半导体测试及新型显示器件检测领域,致力于为行业客户提供测试检测设备及系统解决方案,主要涉及半导体测试设备行业和新型显示器件检测设备行业。

1、半导体测试设备基本情况

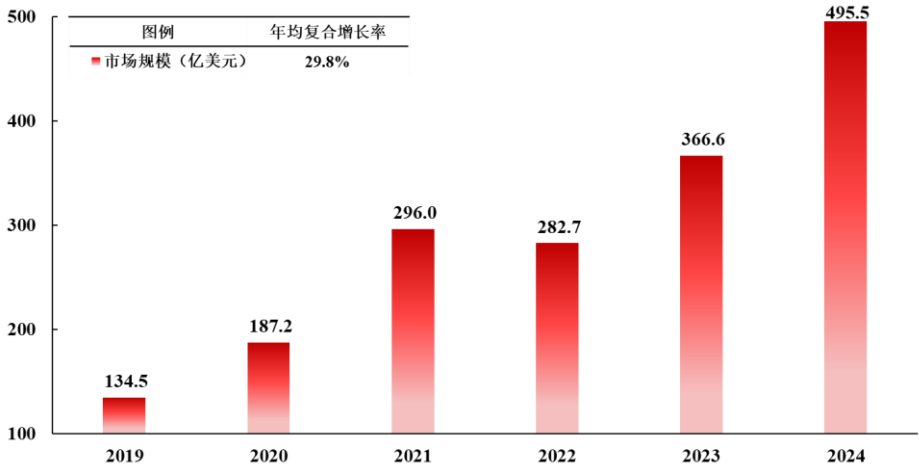
(1) 半导体设备行业基本情况

半导体产品主要细分为集成电路、分立器件、光电子器件和传感器四大类,广泛应用于各类电子产品,是现代电子信息产业的核心基础元器件。其中,集成电路作为半导体产业的核心组成部分,市场规模占据半导体行业规模的八成以上。半导体行业已形成完整的产业链体系,上游为半导体材料、半导体设备等支撑性行业,为中游制造环节提供关键原材料与核心生产设备;中游涵盖芯片设计、晶圆制造和封装测试三大核心环节,是半导体产品实现从设计到成品的关键流程;下游则面向消费电子、汽车电子、航空电子等各类终端产品及其应用行业,应用覆盖范围广泛。



受益于国内晶圆厂的产能持续扩张，中国大陆的半导体设备行业正处于快速发展期，根据 SEMI 数据统计，2024 年度中国大陆地区半导体设备销售额达到 495.5 亿美元，自 2020 年以来连续五年成为全球第一大半导体设备市场。

2019 年度至 2024 年度中国大陆半导体设备市场规模及增速情况



数据来源: SEMI

(2) 半导体测试设备行业基本情况

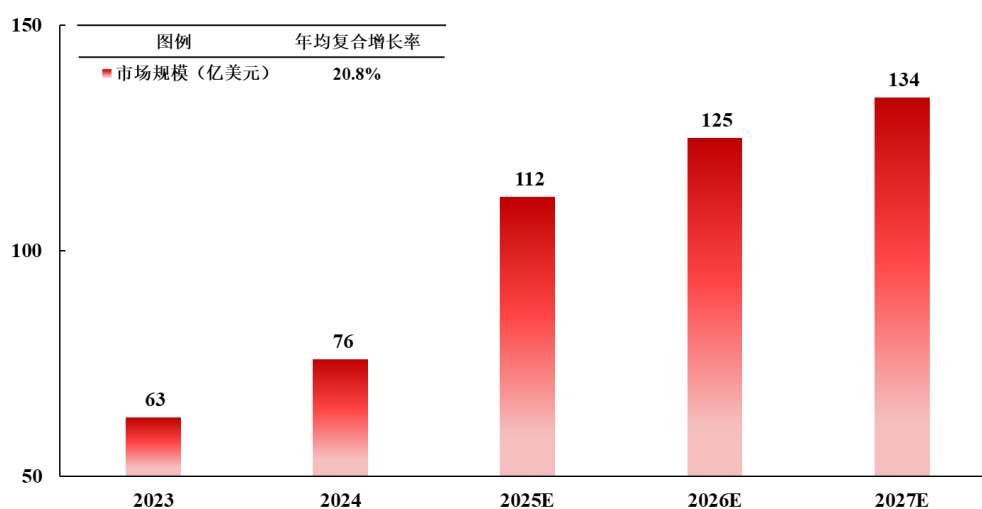
半导体测试贯穿整个半导体制造过程，广义上的半导体测试设备包括前道量测设备和后道测试设备。前道量测设备包括量测类和缺陷检测类质量控制设备；后道测试设备包括晶圆测试设备和封装测试设备，其中，晶圆测试设备主要包括晶圆（CP）测试机、探针台、探针卡等，封装测试设备包括成品（FT）测试机、老化测试及修复设备、分选机等。

随着技术的不断发展，半导体测试设备对于半导体制造的重要性日趋凸显。在芯片设计、制造至封装的全流程中，设计方案缺陷、晶圆质量瑕疵、操作环境洁净度不足，以及颗粒污染、互联失效、静电损伤等工艺缺陷，均会造成晶圆或

最终产品良率下降。同时，随着半导体制造步骤日趋增多，缺陷产生概率将进一步增加，半导体测试设备已经成为保障最终产品良率的关键设备。根据电子系统故障检测的“十倍法则”，芯片故障若未能在测试环节及时发现，则在下一阶段的故障排查、修复成本将呈十倍级攀升，使得半导体测试设备在成本管控与良率保障中的价值愈发关键。当前半导体制造工艺难度的持续提升，叠加 2.5D/3D 封装、Chiplet 等先进封装技术快速普及，亦推动半导体测试设备的技术复杂度和性能水平持续提升。

在下游前沿技术行业需求的快速拉动下，半导体测试设备行业呈现快速发展趋势。根据 SEMI 数据及预测，2025 年全球半导体测试设备销售额将增长 48.10% 至 112 亿美元，2026-2027 年将持续保持增长态势。

2023 年度至 2027 年度全球半导体测试设备市场规模及增速情况



数据来源：SEMI

(3) 半导体测试设备行业发展特点及趋势

① 半导体测试设备与前沿技术发展深度融合，持续推动产品创新

半导体测试设备的技术迭代速度与芯片制程升级、架构创新保持着高度同步发展。下游新兴领域 AI、HBM 推动 2.5D/3D 封装、Chiplet 等先进封装技术的快速发展，芯片集成度和结构复杂度持续提升，应用场景不断延伸，测试设备需持续提升测试精度、测试速度与多维度适配能力。因此，半导体测试设备企业需要持续加大研发投入，紧跟芯片技术迭代节奏，与下游客户深度协同，提前参与芯片设计阶段的测试方案规划，适配芯片的个性化测试需求，形成“芯片设计-测试方案研发-设备量产-落地验证”的闭环协同模式。

②半导体测试设备高速化、平台化、智能化趋势明显

随着芯片制程升级、架构创新及应用场景不断拓展，半导体测试设备的技术壁垒持续提升。测试速度方面，面向 AI 算力芯片、高端存储芯片、先进 SoC 芯片等产品，测试设备向高通道数、高信号速率、高并行度、高测试覆盖率方向发展，以满足高速传输、低时延、高可靠性的严苛测试要求。平台化集成方面，行业主流厂商均采用通用化、模块化软硬件架构，实现同一平台兼容多品类芯片测试，有效降低客户产线改造成本、提升适配效率。智能化方面，行业加速将 AI 算法、大数据分析测试流程深度融合，显著提升测试效率与产品良率。

③半导体测试设备自主可控和国产化战略持续深化

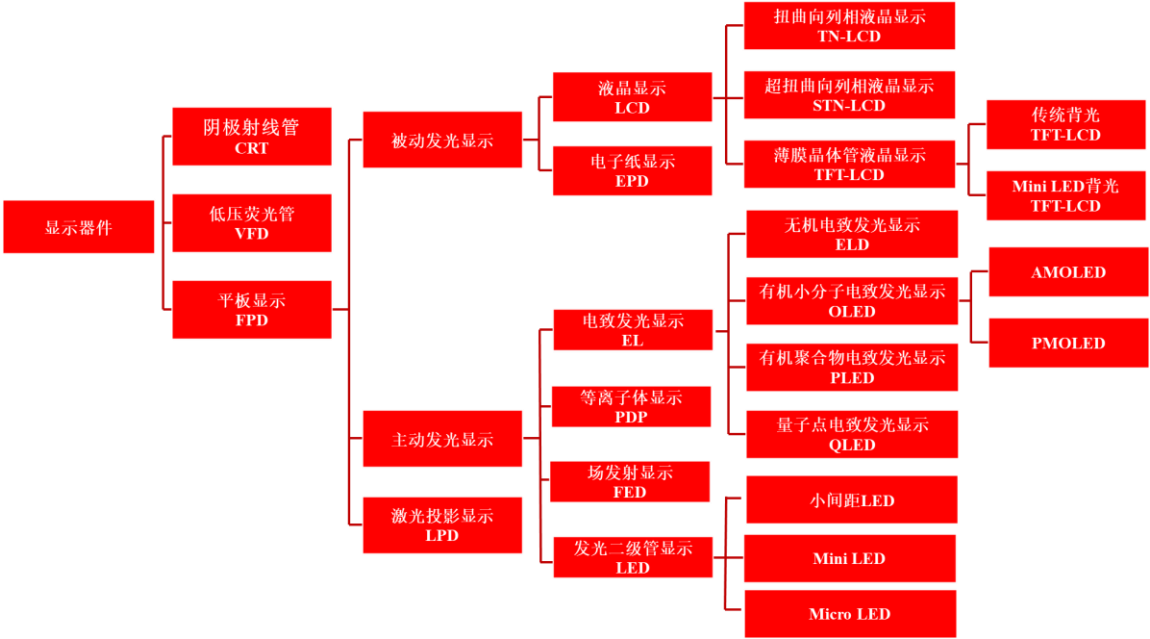
全球半导体测试设备市场由国际龙头厂商主导，高端领域国产化率较低，替代空间广阔。在产业链自主可控政策支持与供应链多元化需求推动下，国内半导体测试设备企业持续突破核心技术，国产替代成果逐步体现，公司等国内厂商陆续在半导体测试设备细分领域实现突破并形成市场优势地位，市场影响力稳步提升。

2、新型显示器件检测设备行业基本情况

（1）新型显示行业基本情况

显示器件在信息交流中承担了人机交互作用，是信息传输过程中的关键环节。按照显示原理的不同，主流的平板显示器件（FPD）可以分为主动发光显示（像素发光，短程成像）、被动发光显示（像素不发光，依靠外部光源）、激光投影显示（像素发光，长程成像）。其中，被动发光显示主要包括液晶显示（LCD）、电子纸显示（EPD）等，主动发光显示主要包括电致发光显示（EL）、等离子体显示（PDP）、场发射显示（FED）、发光二极管显示（LED）等。

根据中国光学光电子行业协会数据，2024 年我国新型显示行业的产值规模突破千亿美元，达到 7,400 亿元人民币，同比增速 12%，在全球市场中占比超过 49%。预计 2025 年我国新型显示行业的产值规模将超过 1,100 亿美元，接近 8,000 亿元人民币，同比增速 5%左右，在全球市场中占比近 54%。



目前主要应用的新型显示器件中，AMOLED 产品的工艺持续改进，应用形态快速拓展，技术创新与规模效应带动成本不断下降，目前在以手机为代表的消费电子领域渗透率逐步提升。

与此同时，Mini LED、Micro LED、Micro OLED 等技术崭露头角，国内外微型显示器件制造厂商争相投资加码。根据 IDC 数据，2024-2029 年全球 AR/VR 市场投资规模将增至 397.0 亿美元，复合年均增长率为 21.1%；中国市场增长态势尤为突出，复合年均增长率达 41.4%，成为全球行业增长的核心引擎。下游新兴应用市场的快速扩张，为国内新型显示器件检测设备厂商创造显著的增量市场空间。

（2）新型显示器件检测设备行业基本情况

新型显示器件制造设备主要包括显影设备、蒸镀设备、激光设备、组装设备、检测设备等。新型显示器件制造设备行业发展受下游产业的新增产线投资及因新技术、新产品不断出现所产生的产线升级投资所驱动，与显示产业的发展具有极高的联动性。根据北京市电子科技情报研究所报告，在新型显示器件产线的投资中，通常表现出“产能扩产、设备先行”的特征，对设备的投资占产线总投资的 60%-80%。

其中，检测设备贯穿新型显示器件生产过程的 Array（阵列）→Cell（成盒）→Module（模组）三大制程中，检测设备主要包括 Array 制程光学检测设备、

Array 制程电性及其他检测设备，Cell/Module 制程光学检测设备、Cell/Module 老化及其他检测设备等。

在人工智能与人机交互浪潮的推动下，新型显示行业的蓬勃发展带动新型显示器件检测设备市场规模的持续提升。根据 Valuates Reports 数据显示，2024 年全球新型显示器件检测市场规模达到 28.45 亿美元，预计 2031 年将达到 37.70 亿美元，保持稳步增长态势。

（3）新型显示器件检测设备行业发展特点及趋势

①微显示技术的发展正强劲驱动着检测设备行业的创新与增长

AR/VR 及 AI 眼镜的快速发展驱动 Micro OLED/LED 等微显示技术加速产业化。根据 IDC 数据显示，2024-2029 年全球 AR/VR 市场规模将增至 397 亿美元，CAGR 达 21.1%；其中中国市场表现尤为突出，以 CAGR 41.4%成为全球最重要的增长极。

与此同时，行业头部企业正在微显示行业加速布局。例如，2025 年 Meta 对全球最大眼镜制造商依视路陆逊梯卡进行了战略投资，拟共同推进 AI 智能眼镜的场景落地，并计划推出新品，以进一步夯实产业成长动能。这一趋势不仅推动微显示技术快速创新迭代，更将为国产新型显示器件检测设备厂商创造增量空间。

②AMOLED 产线建设与升级为新型显示器件检测设备行业发展带来广阔市场空间

受益于 AMOLED 技术的不断成熟和良率的不断提升，AMOLED 的屏体尺寸向中尺寸方向迈进，平板电脑、笔记本电脑、工控显示、车载显示等中尺寸应用场景对 AMOLED 的需求正逐步成为现实，尤其是在车载显示方面，AMOLED 技术与 LCD 技术相比，在显示效果、柔性和曲面屏体等方面具备明显优势，客户产品替代需求日趋迫切。在此背景下，国内头部新型显示器件厂商正加速推进 G8.6 产线建设计划，同时也在不断通过技术升级改造方式，扩展既有产线的产能。前述情况为新型显示器件检测设备行业带来增量发展空间。

（四）公司所处行业竞争情况

1、半导体测试设备行业竞争格局及公司市场地位

（1）半导体测试设备行业竞争格局

在半导体产业技术快速迭代的背景下，我国半导体测试设备行业正处于技术升级加速、市场规模持续扩张的高速发展阶段，高端设备市场空间广阔。然而，从竞争格局来看，国内半导体测试设备市场仍由国际龙头厂商主导，呈现寡头垄断的竞争格局，整体国产化水平较低。以半导体测试设备领域核心设备测试机为例，根据中国产业信息网、SEMI 等公开数据，2024 年中国大陆测试机市场主要由国际龙头垄断，国际前两大测试设备厂商在中国大陆测试机市场合计占有率高达 80%。

近年来，国内厂商在半导体测试设备领域国产替代成果逐步体现，精智达等国内厂商陆续在半导体测试细分领域实现突破并形成市场优势地位，但在全球市场中占比依然相对有限，未来市场空间依然较大。

（2）公司所处的行业地位

在 AI 加速赋能产业创新以及我国半导体产业加速实现自主可控的时代背景下，公司以打造半导体测试检测设备平台型企业为战略目标，以测试检测技术为核心入口、以 AI 为关键驱动力，持续深化技术创新与产业应用融合，不断完善多场景系统化解决方案能力，稳步提升在产业链中的战略地位与行业影响力。

依托在半导体存储测试领域多年深耕与自主创新，公司在海量通道高速信号连接、高精度时序信号生成及驱动、DRAM 测试及修复算法、宽温区高均匀度老化控制等关键领域形成深厚技术积累，产品创新持续取得突破进展，已形成覆盖半导体存储器测试领域关键设备与配套治具的完整产品线，是国内少数实现半导体存储器测试设备全覆盖的厂商，助力我国半导体产业链关键生产环节自主可控。报告期内，公司核心产品线多项关键性能指标达到国际先进水平，具备参与高端测试设备市场竞争的技术基础与能力。

2、新型显示器件检测设备行业竞争格局及公司市场地位

（1）新型显示器件检测设备行业竞争格局

我国新型显示器件检测设备市场主要企业由显示器件产业起步较早且发展成熟的韩国企业、日本企业、中国台湾地区企业以及迅速发展的中国大陆地区企业构成。其中，在 Array 制程，检测系统市场仍然由韩国 HB Technology、韩国 Yang Electronic、韩国 DIT 等境外供应商占据主要份额。在 Cell 制程和 Module 制程，韩国 YWDSP、韩国 ANI 等境外企业曾是新型显示器件厂商主要设备供应商，近年来以公司、精测电子等为代表的中国大陆新型显示器件检测系统生产企业凭借技术自主可控取得快速发展，下游行业的认可度逐渐提升，市场影响力不断增强，在国内市场逐步取得优势地位。

（2）公司所处的行业地位

公司致力于加速关键产品的国产化替代进程，并持续深化自主技术创新。在柔性 AMOLED 领域，公司核心产品已在包括多家国内主流新型显示器件厂商制造产线批量应用，涵盖从 Cell 段到 Module 段所有的检测设备，市占率持续提升；在中尺寸 AMOLED 领域，公司加快推进技术的更新迭代与创新研发，在车载、笔电、折叠屏等领域快速适配客户新需求，积极研发可适用于 G8.6 AMOLED 产线的 Cell 及 Module 相关检测设备，积极参与主要客户新产线相关需求产品的技术验证测试和设备评估，并取得批量订单；在微显示领域，公司与国内外行业龙头企业保持良好的业务关系，开发出用于 Micro LED/Micro OLED 的晶圆显示 AOI 检测设备、模组系统级检测设备、老化设备、信号发生器等产品，并实现量产销售。

四、主要业务模式、产品或服务的主要内容

（一）公司主要业务模式

1、盈利模式

公司通过向下游半导体存储和新型显示制造厂商销售设备、配件或提供服务实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于设备及配件的销售等，其他业务收入来源于设备维护服务等。

2、研发模式

公司严格践行“量产一代、在研一代、预研一代”的阶梯式可持续研发节奏，构建产业化落地与技术迭代双向赋能的良性循环，从而保障业务的持续拓展，并

为长期发展奠定坚实基础。公司研发团队密切关注及学习半导体存储器件及新型显示器件行业的先进技术，及时把握下游行业发展动向和产品革新信息，设定前瞻式研发计划，针对潜在目标市场提前进行技术储备。同时，公司研发团队基于不同的项目特点，进行需求细化和技术分析，结合公司已有的研发成果，组织研发力量进行技术开发及产品交付，在项目完成后将技术成果模块化、固定化，便于后续其他项目与产品研发重复使用与调取。通过市场与研发的衔接，公司的研发工作持续输出，确保在技术上的可行性和经济收益上的稳定性，有效提高研发效率，降低研发风险。

3、采购模式

公司主要根据产品销售订单设计参数并出具物料清单，制定原材料采购计划。对于部分交货期较长的核心原材料，公司根据市场情况进行适量备货，以及及时响应客户需求。公司综合考虑产品质量、采购价格、订单交期、售后服务及合作关系的稳定性等因素选择供应商，已与主要供应商建立了长期且稳定的合作关系。

4、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，根据客户对所需产品的性能、规格、配置的要求进行定制化生产。公司产品生产严格遵循研发定型的硬件图纸与工艺说明，经过物料采购、硬件装配、软件安装、系统调试等一系列生产流程控制和严格的质量检验，最终交付客户合格的产品。

5、销售模式

公司采用直销模式，产品主要向下游客户直接销售，通过商业谈判或招投标方式获取订单。公司与产业下游主流厂商建立了稳定的合作关系，深入了解客户需求，不断完善产品和服务，增加市场份额和品牌知名度。

（二）公司主要产品或服务的主要内容

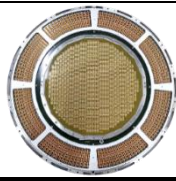
公司聚焦半导体测试及新型显示器件检测领域，致力于为行业客户提供测试检测设备及系统解决方案，以实现关键设备自主可控为核心目标，持续深耕半导体测试检测设备行业，围绕半导体存储器测试设备及新型显示器件检测设备核心业务持续延伸、拓展基于 AI 技术发展的系统化全站点服务能力。

1、半导体测试解决方案

公司半导体测试方案主要面向 DRAM 等存储器领域，覆盖晶圆制造环节的裸片电性能与功能测试，以及封装测试环节的芯片颗粒电参数测试、功能测试、老化测试及修复，确保产品符合设计规范。此外，公司还积极布局算力芯片测试设备，旨在提升 SoC 芯片的测试效率与精度、降低测试成本，进一步丰富产品广度和深度。

公司半导体存储器件测试解决方案涵盖晶圆测试设备、老化测试及修复设备、封装测试设备及其他测试配件。主要产品如下：

（1）存储器晶圆测试设备

主要产品名称	产品简介	产品图示
晶圆测试机	针对 DRAM 晶圆在封装前的功能指标测试、电学参数测试及缺陷修复需求，提供专用的晶圆测试设备解决方案	
MEMS 探针卡	主要用于晶圆测试时实现测试机与被测芯片的电气联接,通过传输信号对芯片参数进行测试	

（2）存储器老化测试及修复设备

主要产品名称	产品简介	产品图示
老化测试及修复设备	对封装后的芯片颗粒进行高低温与大电流环境下的老化测试,在测试中对颗粒内部缺陷进行修复	
老化测试及修复治具板	主要用于连接封装后 DRAM 芯片和老化测试 BI 设备,是老化测试及修复设备中重要的部件	

（3）存储器封装测试设备

主要产品名称	产品简介	产品图示
DRAM FT 测试机	对封装后的 DRAM 颗粒进行功能与高速接口测试	
DRAM 通用测试验证系统（UDS）	面向 DRAM 设计及制造企业研发的紧凑型便携式可移动测试系统	

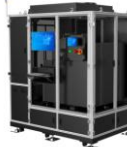
2、新型显示器件检测解决方案

公司新型显示器件检测解决方案主要用于 AMOLED、TFT-LCD、微显示等新型显示器件的 Cell 与 Module 制程的光学特性、显示缺陷、电学特性等各种功能检测及校准修复，用于产品缺陷检测、产品等级判定与分类，对部分产品缺陷进行校准、修复及复判，从而提升产品良率、降低生产损耗，并为相关工序的工艺提升提供数据支撑。

公司新型显示器件检测解决方案主要包括光学检测及校正修复系统、老化系统、信号发生器及检测系统配件等，具体情况如下：

（1）光学检测及校正修复系统

主要产品名称	产品简介	产品图示
Cell 光学检测设备	主要用于新型显示器件 Cell 制程的自动对位压接、白平衡调节、点灯/外观缺陷 AOI 检测、自动分类分级下料等工序	
Module 光学检测设备	主要用于新型显示器件 Module 制程的 Gamma 调节、AOI 检查、外观检查等工序	
Gamma 调节设备	主要用于新型显示器件 Module 制程的 Gamma 调节	

主要产品名称	产品简介	产品图示
Micro LED/OLED 模组 AOI 检测设备	主要用于封装后 Micro LED/OLED 模组的 Mura 补偿，及点灯与外观缺陷 AOI 检测	
Wafer AOI 设备	对硅基 Micro LED/OLED 点亮后的光、电性能进行拍照分析,应用于 Wafer 段点灯工序的功能与缺陷检测，适用 XR 检测	

(2) 老化系统

主要产品名称	产品简介	产品图示
Cell 老化设备	主要用于新型显示器件 Cell 制备后的点亮老化	
Module 老化设备	主要用于新型显示器件 Module 开发设计过程中的例行试验，以及量产过程中的检验	
Micro LED 老化设备	主要用于新型显示器件 Module 在点亮状态下的品质验证与老化测试,提供温度环境以确认可靠性，适用 XR 检测	
Micro OLED 老化设备	用于新型显示器件 Module 开发设计及量产中、产品点亮状态下的品质验证和老化测试,提供温度运行环境以确认产品的品质可靠性，适用 XR 检测	

(3) 信号发生器及光学仪器

主要产品名称	产品简介	产品图示
Cell 信号发生器	主要用于新型显示器件 Cell 制程的检测信号及电源供给，可用于点灯检测及老化等工序	
Module 信号发生器	主要用于新型显示器件 Module 制程，可用于点灯检测、Gamma 调节、Mura 补偿及老化等工序	

主要产品名称	产品简介	产品图示
老化测试信号发生器	主要用于 AR 显示模组产品高温/常温老化测试等应用场景	
微显示信号发生器	主要用于 AR 显示模组产品检测等应用场景，提供多路高精度电源及 MIPI、LVDS、QSPI 等信号	
成像式亮度计	主要用于显示器件、Micro-LED、Mini-LED、AR/VR 近眼显示、车载显示、背光模组及光学模组等领域的亮度均匀性和缺陷检测	
成像式色度计	主要用于显示面板、Micro-LED、OLED、AR/VR 近眼显示、车载显示及背光模组等领域，用于评估上述产品的亮度、色度均匀性及显示品质检测	

（4）检测系统配件

检测系统配件主要包括检测治具、检测耗材及其他辅助设备等。

（三）重大资产重组情况

公司自上市以来，不存在重大资产重组的情况。

（四）发行人境外经营情况

截至本募集说明书签署日，公司在境外拥有全资子公司香港精智达，具体情况如下所示：

公司名称	精智达（香港）有限公司 Seichitech（Hongkong）Limited
成立时间	2017 年 5 月 31 日
注册资本	100 万美元
注册地址/主要生产经营地	UNIT 01A, 21/F., NEW TREND CENTRE, 704 PRINCE EDWARD ROAD EAST, SAN PO KONG, KOWLOON, HONG KONG
在发行人业务板块中定位	境外业务平台
股权结构	精智达持股 100%
最近一年主要财务数据（单位：万元）	

日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	7,471.23	2,443.58	12,911.90	560.51

五、现有业务发展安排及未来发展战略

（一）公司现有业务发展安排

公司持续深耕半导体测试检测设备行业，以实现关键设备自主可控为核心目标，围绕核心业务持续延伸、拓展基于 AI 技术发展的系统化全站点服务能力。

（二）公司未来发展战略

基于当前 AI 加速赋能产业创新以及我国半导体产业链加速实现自主可控的时代背景下，公司以建设行业领先的半导体测试检测设备平台型企业为发展目标，以测试检测技术为核心入口、以 AI 为关键驱动力，持续推动技术创新与产业应用深度融合，构建覆盖多应用场景的系统化解决方案能力，提升公司在产业链中的战略地位与行业影响力。

技术研发方面，公司围绕存储测试设备、算力芯片测试设备、探针卡、XR 检测设备、AMOLED 检测设备五大核心产品，坚持技术自主创新，持续加大研发投入与前沿技术布局，强化底层技术能力，并加快推进 AI 技术在测试检测场景中的深度融合应用，提升产品性能、测试检测效率与数据价值，持续巩固公司技术领先优势。

产业能力方面，公司稳步推进产业化能力建设与制造体系升级，持续完善研发、生产、供应链、质量及服务全流程协同机制和平台化建设，提升产品稳定性、规模化交付能力与运营效率，为业务持续增长提供坚实产业基础与体系保障。

市场与生态布局方面，公司坚持立足国内产业链协同生态，稳步推进全球市场拓展与重点客户合作，在合规与风险可控前提下，把握行业技术升级与结构性机遇，持续拓展应用领域与业务空间，增强公司长期成长韧性。

面向未来，公司将始终以技术创新为长期驱动力，以平台化能力为核心支撑、以产业链协同为重要发展路径，推动企业经营规模、发展质量与产业价值协同提升，稳步向国内领先的半导体测试检测设备平台型企业的目标迈进。

六、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况

（一）财务性投资的认定标准

根据《证券期货法律适用意见第18号》的规定，财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资或产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。金额较大是指公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

（二）最近一期末发行人持有的对外投资情况

截至2025年12月31日，公司对外投资的相关科目列示如下：

单位：万元

序号	项目	金额	是否包含财务性投资
1	交易性金融资产	25,039.33	否
2	其他应收款	543.59	否
3	一年内到期的非流动资产	3,253.53	否
4	其他流动资产	3,197.82	否
5	长期股权投资	5,941.69	否
6	其他非流动金融资产	41.91	否
7	其他非流动资产	22,875.19	否

（1）交易性金融资产

截至2025年12月31日，公司交易性金融资产主要为低风险、流动性好的理财产品，不属于财务性投资。

（2）其他应收款

截至2025年12月31日，公司其他应收款主要系押金保证金等，不属于财务性投资。

（3）一年内到期的非流动资产

截至 2025 年 12 月 31 日，公司一年内到期的非流动资产主要系一年内到期的大额存单，不属于财务性投资。

（4）其他流动资产

截至 2025 年 12 月 31 日，公司其他流动资产主要系增值税留抵扣额、以抵销后净额列示的所得税预缴税额、待摊费用，不属于财务性投资。

（5）长期股权投资

截至 2025 年 12 月 31 日，公司长期股权投资为对联营企业珠海冠中和深圳高铂的投资。其中，珠海冠中主营业务为集成电路测试系统的研制、生产制造、销售服务；深圳高铂主营业务为集成电路测试设备芯片设计与销售，上述股权投资与公司主营业务具有较强的协同性，符合公司战略发展方向，不属于财务性投资。

（6）其他非流动金融资产

截至 2025 年 12 月 31 日，公司其他非流动金融资产主要系公司于 2023 年 4 月与联营企业珠海冠中签订了附有回购条款的股东协议，根据《企业会计准则》规定该股权投资回购权计入其他非流动金融资产。该股权投资是公司基于自身的发展战略围绕主营业务进行的投资，不属于财务性投资。

（7）其他非流动资产

截至 2025 年 12 月 31 日，公司其他非流动资产主要系预付购买软件、固定资产款项、预付装修款、预付投资款及长期大额存单。其中，预付投资款系公司预付给杭州灵伴科技有限公司的战略投资款，杭州灵伴科技有限公司主要从事 AR 眼镜等人机交互智能产品的研发、销售，上述股权投资系公司围绕主营业务和产业链上下游进行的投资，不属于财务性投资。

综上所述，截至最近一期末公司不存在大额财务性投资情况。

七、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施

（一）公司科技创新水平

1、产品创新与技术创新能力突出

在半导体存储器测试领域，公司开展了针对半导体存储器后道测试工艺的全系列产品研发，包括晶圆测试机及探针卡、老化测试及修复设备及老化修复治具板、FT 测试机及治具（DSA）等，其中老化测试及修复设备、治具板及探针卡等已经成为客户主要供应商。在此基础上，公司根据新技术和新应用在半导体存储器和 AI 算力芯片方面的新要求，配合客户业务稳步推进基于半导体封装技术的测试技术和设备。公司已基本实现半导体存储器件测试设备的全面布局，能够为客户提供系统化解决方案，初步形成全站点服务能力，具备较强的竞争优势。

在新型显示器件检测领域，公司以光、算、电的核心技术积累为基础，推出了覆盖新型显示器件的 Cell 和 Module 制程、硅基微显示器件的缺陷检测及校准修复的各类自动设备，形成具有强竞争力且覆盖主要工艺节点的完整产品线，多类设备在国内取得了稳定的市场份额。同时，公司积极布局前沿显示的检测设备，具备了较完善的微显示检测系统解决方案，并率先实现向海外重要 AR/VR 终端客户提供定制化系统化检测解决方案，具备先发优势。

2、研发团队经验丰富、技术积累深厚

公司聚焦于半导体测试领域和新型显示器件检测领域，拥有专业的研发团队和技术支持团队，始终坚持研发导向、客户导向，紧跟半导体存储测试和新型显示技术的发展趋势，积累了多项自主研发的核心技术成果，不断突破了技术难点、完善了技术体系。截至 2025 年末，公司累计取得知识产权超过 500 项，其中发明专利超过 170 项，并掌握了多项生产技术诀窍、工艺控制参数等非专利技术。基于较强的技术实力积累，公司能够积极顺应市场工艺水平的提升，进行技术创新和设计改进，持续优化产品性能，抢占高性价比新产品的先发优势。

（二）保持科技创新能力的机制或措施

1、建立技术引领与市场导向的创新机制，持续加大研发投入，保持核心技术领先优势

公司以技术创新为驱动，聚焦于半导体测试领域和新型显示器件检测关键技术的研发和产业化。一方面，坚持通过完善的研发架构，保持高研发投入，推进前沿技术研究和核心技术研发，积极推动与外部机构的技术合作及交流，努力建立技术领先优势。另一方面，坚持将技术创新服务于客户，以市场和客户需求为导向确定产品和解决方案研发方向，使创新技术能够具有明确的目标定位实现产业化落地，从而提高公司产品竞争力和市场地位，并有效提升研发投入的转化率。

2、重视人才培养，加强研发队伍建设

公司高度重视人才的培养和研发队伍的建设。一方面，为了保证人才引进和招聘质量，公司建立了一套严格完善的人才选拔机制，通过丰富多样的人才引进渠道公开、公平、公正、科学合理地引进各类高素质优秀人才。另一方面，公司根据技术研发方向规划和业务需要定期或不定期举行培训，加速人才成长，为公司未来业务发展奠定基础。

3、建立绩效考核与激励机制，保障核心团队稳定性

公司建立了完善科学的绩效考核与激励机制，以鼓励研发人员积极进行自主创新。公司将创新成果作为研发人员绩效考核的重要指标，并以此为依据进行激励，调动研发人员的积极性并避免了核心研发人员的流失。同时，公司每年度对核心技术人员和骨干员工在股权激励、内部培养等方面进行重点培养和激励。此外，公司建立了科技成果转化的激励奖励机制，加速新技术应用。

4、加强知识产权管理，打造自有知识产权体系

公司高度重视知识产权管理，通过制定专门的知识管理制度，配置专人跟踪行业技术动态、检索技术信息，对公司专利权、软件著作权等知识产权进行申请与管理。公司注重核心技术的保护工作，通过专利申请以及专有技术保密相结合的方式技术保护，打造自有知识产权体系和核心技术体系。

第二节 本次证券发行概要

一、本次发行的背景和目的

（一）本次向特定对象发行的背景

1、国家相关产业政策为半导体测试设备企业发展营造了良好的宏观环境

半导体产业是信息技术产业及现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是当前衡量一个国家或地区综合竞争力的重要标志。半导体设备作为半导体产业发展的核心驱动力，近年来国家出台一系列鼓励扶持政策，为其高质量发展提供坚实支撑，具体如下：

序号	时间	发文部门	法律法规及政策	主要内容
1	2026 年 3 月	中共中央	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	聚焦战略必争领域和产业链供应链薄弱环节，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。
2	2025 年 8 月	工信部、市监总局	《电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案》	坚定不移推动“国货国用”，持续推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链……强化计算等领域芯片、零部件、整机系统等研发应用和配套适配。
3	2024 年 7 月	中国共产党二十届三中全会	《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》	抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。
4	2024 年 1 月	工信部等七部门	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	创新标志性产品：新型显示：加快量子点显示、全息显示等研究，突破 Micro-LED、激光、印刷等显示技术并实现规模化应用。
5	2023 年 2 月	工信部等七部门	《智能检测装备产业发展行动计划（2023—2025 年）》	供给能力提升重点方向：关于电子行业方面，突破电性能测试系统、高精度探针台等。
6	2023 年 12 月	国家发改委	《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	将球栅阵列封装（BGA）、插针网格阵列封装（PGA）、芯片规模封装（CSP）、多芯片封装（MCM）、栅格阵列封装（LGA）、系统级封装（SIP）、倒装封装（FC）、晶圆级封装（WLP）、传感器封装（MEMS）、2.5D、3D 等一种或多种技术集成的先进封装与测试，集成电路装备及关键零部件制造列为鼓励类产业。

序号	时间	发文部门	法律法规及政策	主要内容
7	2021 年 12 月	财政部等五部门	《国家支持发展的重大技术装备和产品目录（2021 年修订）》	集成电路自动化测试及分选设备属于国家支持发展的重大技术装备和产品。

公司持续深耕半导体测试检测设备行业，以实现关键设备自主可控为核心目标，围绕核心业务持续延伸、拓展基于 AI 技术发展的系统化全站点服务能力。国家陆续出台的相关产业政策，充分凸显了公司所属行业在国民经济中的重要地位，各项政策的密集发布与落地实施，为公司业务发展营造良好经营环境，并提供坚实有力的政策支撑。

2、下游新兴需求的不断涌现及国产替代进程加快为半导体测试设备企业发展提供了巨大的市场空间

下游前沿技术迭代与终端产品创新形成的新需求，正从多维度推动半导体测试检测设备的技术升级。AI 作为推动科技进步与产业变革的核心力量，其生态构建日趋完善，持续推升算力需求。与此同时，HPC、XR 等应用对芯片算力、存储带宽及人机交互、显示精度要求不断提升。

随着摩尔定律逐渐逼近极限，2.5D/3D 封装、Chiplet 等先进封装技术成为关键路径，芯片结构从平面走向立体，其复杂的互连结构与集成形态对测试设备的信号精度、多通道协同能力及系统兼容性提出更高要求。HBM 凭借高带宽优势已成为高性能计算和 AI 的重要解决方案，驱动测试设备向高精度、高并行测试能力方向迭代。设备架构复杂化及 AI 对高性能的需求共同推动半导体测试设备市场增长。根据 SEMI 预测，2025 年全球半导体测试设备销售额将增长 48.10% 至 112 亿美元。同时，XR 及智能眼镜的快速发展亦驱动 Micro OLED/LED 等微显示技术加速产业化。根据 IDC 数据显示，2024-2029 年全球 AR/VR 市场规模将增至 397 亿美元，复合增长率达 21.1%，其中，中国市场表现尤为突出，以 41.4% 的复合增长率成为全球最重要的增长极。这一趋势不仅推动微显示技术快速迭代，更将为国产检测设备厂商创造增量空间。

随着全球贸易摩擦加剧，我国半导体产业面临着供应链安全和技术突破的严峻挑战，高端半导体测试检测设备进口替代需求日益迫切。在此背景下，我国高端半导体测试检测设备国产化进程有望进一步加速，本土厂商必将充分受益。

3、提升高端半导体存储测试设备产业化能力、巩固并进一步提升公司在半导体测试设备领域市场地位和竞争力

全球及中国半导体测试设备市场正进入由 AI 算力、先进封装等驱动的强劲扩张期。根据 SEMI 预测，2025 年全球半导体测试设备销售额将增长 48.10%至 112 亿美元。根据 Trend Force 数据，2025 年国内 DRAM 晶圆投入量预计达 273 万片，同比增长 68.5%，国内主流存储厂商正加速扩产与技术升级。在此背景下，国内对高端半导体存储测试设备的配套需求必将呈现同步快速增长。

受 AI 时代下 HBM、算力芯片等高端测试需求爆发式增长的影响，高端半导体存储测试设备市场面临持续供应缺口。与此同时，随着中国加快构建自主供应链建设，国内对本土高端半导体存储测试设备需求将进一步增加。

公司是国内少数实现半导体存储器测试设备全覆盖的厂商，已于部分产线成功取代国外供应商成为相关产品主要供应商，实现重要生产环节自主可控。下游客户旺盛的市场需求给公司提供良好市场机遇期。然而，公司高端半导体存储测试设备产业化能力目前难以满足下游客户的设备需求，提升高端半导体存储测试设备产业化能力有其迫切性，有利于巩固并进一步提升公司在半导体测试设备领域市场地位和竞争力。

4、积极践行国家半导体产业的关键核心技术攻关和科技突破的发展战略，以技术创新引领新质生产力发展

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》提出“聚焦战略必争领域和产业链供应链薄弱环节，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破”。

公司深刻把握十五五规划的战略导向，立足行业发展前沿，以成为半导体测试设备领域技术引领者为目标，持续深化科技创新。本次发行是公司响应国家战略的关键举措，旨在突破高端半导体测试设备关键核心技术自主可控难题，持续迭代半导体存储测试、AI 芯片测试等高端半导体测试设备，以进一步夯实公司自身技术壁垒，提升创新能力，更将以自主创新技术带动产业链上下游协同升级，引领半导体测试设备领域新质生产力发展，为国家集成电路产业高质量发展提供

核心装备支撑。

（二）本次向特定对象发行的目的

1、把握行业发展机遇，提高公司高端半导体测试设备产业化能力，深化“设备平台+解决方案”的综合能力

公司持续深耕半导体测试检测设备行业，以实现关键设备自主可控为核心目标，围绕核心业务持续延伸、拓展基于 AI 技术发展的系统化全站点服务能力。依托多年在半导体存储测试领域的深耕积累和自主创新，产品线已覆盖半导体存储器测试领域的关键测试设备和治具，主要产品包括晶圆测试设备、老化测试及修复设备、DRAM FT 测试设备、MEMS 探针卡、老化治具板、FT 测试治具等，是国内少数实现半导体存储器测试设备全覆盖的厂商，已于部分产线成功取代国外供应商成为相关产品主要供应商，实现重要生产环节自主可控。

近年来，受益于下游市场需求旺盛、公司技术迭代与应用场景的不断拓展，公司半导体测试设备业务呈现快速增长趋势。然而，当前半导体产业正经历深刻变革，AI、HBM 等新兴领域推动 2.5D/3D 封装、Chiplet 等先进封装技术的快速发展，芯片内部结构日趋复杂，性能水平持续提升，相应对半导体测试设备的技术水平提出更高要求。目前，作为 AI 和 HPC 芯片中关键部分的 HBM 的测试逻辑已发生根本性变化。由于 HBM 堆叠层数高且与 GPU 深度绑定，测试模式已从传统的“抽样测试”转向“全深度测试”，这导致测试时间大幅延长，从而推高了测试设备的需求量。HBM 的复杂性和高价值属性使得存储测试设备需求呈现出技术升级和测试密度提升所带来的结构性增长机会。

为了更好地满足客户对高端半导体测试设备日益增长的市场需求，公司需要持续提升高端半导体测试设备的产业化能力，进一步提升“设备平台+解决方案”的综合服务能力，巩固并提升公司在半导体测试设备领域的竞争力。本次募集资金投资项目的实施有助于公司持续提高半导体测试设备升级迭代及产业化能力，抓住行业高速发展机遇。

2、增强公司研发实力，持续提升公司产品和技术创新能力

公司所处行业为知识和技术密集型行业，产品研发涉及电子电路设计、精密光学、精密机械设计与自动化控制，以及软件算法等多学科、多领域知识的综合

运用，具有较高的技术和客户验证壁垒。国外龙头设备厂商通过长期大规模的研发投入，以此保持产品技术优势并巩固行业领先地位。

公司聚焦于半导体测试检测设备及系统解决方案领域，具有较强的竞争优势，但受限于技术积累、研发资金实力等因素，在产品与研发布局方面与国外龙头厂商尚存在一定差距，需要持续的研发投入，以提升公司整体研发实力及技术优势。随着人工智能与实体经济加速融合、微显示技术的产业化加速以及终端应用场景多元化趋势，下游客户对设备供应商的要求日趋提高，不仅要提供高精度检测硬件，还需结合 AI 算法、数据分析构建定制化解决方案。为了持续满足下游客户的产品迭代需求，公司需要持续提升半导体测试检测方面的研发能力和技术竞争力。

本次募集资金投资项目的实施有助于公司紧跟行业发展前沿趋势和客户需求，布局半导体测试检测设备领域前沿技术，进一步增强公司研发实力，逐步缩小与国外龙头厂商的差距，更好地满足下游客户在新兴领域对更高测试性能指标的迫切需求，为实现我国半导体测试检测设备自主可控贡献力量。

3、增强公司资金实力，提升运营能力，推动公司持续高质量健康发展

公司所处行业为资金密集型行业，技术研发、生产运营及相关服务都需要大量的持续资金投入。目前，公司正处于业务发展重要机遇期，在巩固既有业务优势的同时，持续聚焦新技术突破、新产品落地及新市场拓展，核心业务板块保持稳健增长。公司经营规模的持续扩大，带动原材料采购、薪酬支出、市场开拓等方面对营运资金的需求不断增加，加之存货、应收账款等经营性项目的资金占用规模相应增长，为了更好地开拓市场及支撑公司持续增长的采购需求，公司需要补充并维持一定规模的营运资金以支撑业务快速扩张。

通过本次向特定对象发行，公司将充分利用资本市场优势，增强自身资金实力，部分募集资金拟用于补充流动资金，以满足公司日益增长的经营性现金流需要，提高公司抗风险能力，持续增强公司核心竞争力和盈利能力。

二、发行对象及其与公司的关系

本次发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机

构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会做出予以注册决定后，由公司董事会根据询价结果，与保荐人（主承销商）协商确定。若发行时国家法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

截至本募集说明书签署日，公司尚未确定本次发行的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司的关系将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期

（一）发行价格及定价原则

本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。

本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$ ；

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送股或转增股本数， $P1$ 为调整后发行价格。

最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会根据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。

（二）发行数量

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 28,238,446 股（含本数）。

最终发行数量将在本次发行获得中国证监会做出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

（三）限售期

本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

发行对象基于本次发行所取得的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

四、募集资金投向

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 285,658.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称		拟投资总额	拟使用募集资金投资金额
1	半导体存储测试设备研发及产业化智造项目	半导体存储测试设备产业化智造项目	44,096.00	39,468.00
		半导体存储测试设备技术研发项目	38,124.00	38,100.00
	小计		82,220.00	77,568.00
2	高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目		158,800.00	153,800.00
3	补充流动资金		54,290.00	54,290.00
合计			295,310.00	285,658.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自有或自筹资金解决。

五、本次发行是否构成关联交易

截至本募集说明书签署日，公司尚未确定本次发行的具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化

本次发行完成后，公司的股本规模、股东结构及持股比例将发生变化，本次发行不会导致公司实际控制人发生变化。

七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议、2026 年第一次临时股东会、第四届董事会第十五次会议、第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会第十六次会议、第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，本次发行已获得上海证券交易所审核通过，尚待中国证监会同意注册。

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 285,658.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称		拟投资总额	拟使用募集资金投资金额
1	半导体存储测试设备研发及产业化智造项目	半导体存储测试设备产业化智造项目	44,096.00	39,468.00
		半导体存储测试设备技术研发项目	38,124.00	38,100.00
	小计		82,220.00	77,568.00
2	高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目		158,800.00	153,800.00
3	补充流动资金		54,290.00	54,290.00
合计			295,310.00	285,658.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自有或自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目的的基本情况

本次募集资金投资项目包括半导体存储测试设备研发及产业化智造项目、高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目以及补充流动资金。其中，半导体存储测试设备研发及产业化智造项目涉及半导体存储测试设备产业化智造项目和半导体存储测试设备技术研发项目两个子项目。本次募集资金投资项目具体情况如下：

（一）项目基本情况

1、半导体存储测试设备研发及产业化智造项目

（1）半导体存储测试设备产业化智造项目

项目名称	半导体存储测试设备产业化智造项目
实施主体	精智达
项目总投资	44,096.00 万元
拟投入募集资金	39,468.00 万元
项目建设内容	本项目拟在深圳市龙华区购置土地建设高标准生产厂房、办公场地等配套设施，引入先进的生产配套设备及软件，打造标准化、现代化、规模化的半导体存储测试设备产业化基地。本项目的实施将进一步缓解公司生产场地主要依赖租赁取得以及生产场地空间瓶颈，有效提升公司高端半导体存储测试设备产业化能力，充分满足下游市场及客户的产品需求，进一步提高公司核心竞争力和市场地位。
项目实施地点	广东省深圳市龙华区观湖街道锦绣科学园 3 期

(2) 半导体存储测试设备技术研发项目

项目名称	半导体存储测试设备技术研发项目
实施主体	精智达
项目总投资	38,124.00 万元
拟投入募集资金	38,100.00 万元
项目建设内容	本项目拟在深圳市龙华区建设研发场地，引入半导体存储测试设备技术和产品研发所需的先进的设备及软件，扩充研发团队，进一步提升公司研发实力。本项目的实施将持续推动公司半导体存储测试设备升级迭代，不断提高产品技术水平和核心竞争力。
项目实施地点	广东省深圳市龙华区观湖街道锦绣科学园 3 期

2、高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目

项目名称	高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目
实施主体	精智达
项目总投资	158,800.00 万元
拟投入募集资金	153,800.00 万元
项目建设内容	本项目拟在长三角打造高端芯片测试设备及前沿技术研发中心，购置先进的软硬件设施，引入优秀技术人才，助力公司深入开展研发活动，持续提升技术研发实力。本项目的实施将充分利用上海及长三角半导体产业区位和资源优势，重点开展公司半导体测试检测设备面向前沿需求的新产品及关键核心技术的研发工作，持续增强公司核心竞争力。
项目实施地点	上海市金桥装备小镇集创园（总部区）

3、补充流动资金项目

公司本次募集资金拟使用 54,290.00 万元用于补充流动资金，有助于解决公司经营发展过程中对流动资金的需求，保障公司可持续发展。

（二）项目经营前景

本次募集资金投资项目系公司根据自身经营需要及未来发展规划、行业技术发展及客户需求变化趋势等多方面因素综合考虑确定,通过本次募集资金投资项目的实施,将进一步提升公司高端半导体测试检测设备研发及产业化能力,持续增强公司核心竞争力,支撑公司高质量可持续发展。本次募集资金投资项目经营前景详见本募集说明书“第二节 本次证券发行概要”之“一、（二）本次向特定对象发行的目的”相关内容。

（三）与现有业务或发展战略的关系

本次募集资金投资项目包括半导体存储测试设备研发及产业化智造项目、高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目以及补充流动资金,上述募投项目紧密围绕公司主营业务展开,是公司现有业务的补充和升级,顺应行业市场发展方向,符合公司业务布局及未来发展战略。具体情况如下:

半导体存储测试设备研发及产业化智造项目将进一步提高公司高端半导体存储测试设备研发及产业化能力,增强公司产品技术能力,不断推动公司现有产品升级迭代,更好满足下游客户对半导体测试设备需求,支撑公司高质量可持续发展。

高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目将进一步提高公司技术创新能力,面向下游市场前沿技术需求,推进公司半导体测试检测设备新产品研发进程,巩固公司产品技术优势,持续提高公司的核心竞争力。

补充流动资金可在一定程度上解决公司未来经营性现金流需求,降低公司财务风险,为公司经营规模快速增长提供相应的资金保障。

（四）项目的投资概况

本次募集资金投资项目总投资规模为 295,310.00 万元,拟使用募集资金投资金额为 285,658.00 万元,涉及半导体存储测试设备研发及产业化智造项目(含“半导体存储测试设备产业化智造项目”和“半导体存储测试设备技术研发项目”)、高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目、补充流动资金。

1、半导体存储测试设备研发及产业化智造项目

(1) 半导体存储测试设备产业化智造项目

本项目计划投资总额 44,096.00 万元，其中拟投入募集资金 39,468.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资总额	占比	拟使用募集资金投资金额	占比
1	场地投资	25,982.00	58.92%	23,305.85	59.05%
2	设备投资	8,858.00	20.09%	7,945.63	20.13%
3	预备费	1,742.00	3.95%	1,562.57	3.96%
4	铺底流动资金	7,514.00	17.04%	6,653.95	16.86%
合计		44,096.00	100.00%	39,468.00	100.00%

(2) 半导体存储测试设备技术研发项目

本项目计划投资总额 38,124.00 万元，其中拟投入募集资金 38,100.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资总额	占比	拟使用募集资金投资金额	占比
1	场地投资	1,958.00	5.14%	1,958.00	5.14%
2	设备投资	2,145.00	5.63%	2,145.00	5.63%
3	研发费用	34,021.00	89.24%	33,997.00	89.23%
合计		38,124.00	100.00%	38,100.00	100.00%

2、高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目

本项目计划投资总额 158,800.00 万元，其中拟投入募集资金 153,800.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资总额	占比	拟使用募集资金投资金额	占比
1	场地投资	7,390.00	4.65%	7,390.00	4.80%
2	设备投资	14,922.00	9.40%	14,922.00	9.70%
3	研发费用	136,488.00	85.95%	131,488.00	85.49%

序号	项目名称	总投资总额	占比	拟使用募集资金投资金额	占比
	合计	158,800.00	100.00%	153,800.00	100.00%

3、补充流动资金项目

公司拟使用募集资金 54,290.00 万元用于补充流动资金。

(五) 项目的实施准备和进展情况、预计实施时间，整体进度安排

1、半导体存储测试设备研发及产业化智造项目

(1) 半导体存储测试设备产业化智造项目

本项目的建设周期为 36 个月，包括项目前期准备及规划设计、工程施工、设备采购、设备安装调试、试运行生产等 5 个阶段，具体时间进度安排如下：

单位：年

项目	T+1				T+2				T+3			
建设周期	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目前期准备及规划设计												
工程施工												
设备采购												
设备安装调试												
试运行生产												

注：T 代表项目开始时点。

(2) 半导体存储测试设备技术研发项目

本项目的建设周期为 60 个月，包括项目前期准备、实施场地准备、设备采购、人员招聘及培训、项目研发等 5 个阶段，具体时间进度安排如下：

单位：年

项目	T+1				T+2				T+3				T+4				T+5			
建设周期	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目前期准备																				
实施场地准备																				
设备采购																				
人员招聘及培训																				

项目	T+1				T+2				T+3				T+4				T+5			
建设周期	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目研发																				

注：T 代表项目开始时点。

2、高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目

本项目的建设周期为 60 个月，包括项目前期准备及规划设计、工程施工、设备采购、设备安装调试、试运行生产等 5 个阶段，具体时间进度安排如下：

单位：年

项目	T+1				T+2				T+3				T+4				T+5			
建设周期	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目前期准备																				
实施场地准备																				
设备采购																				
人员招聘及培训																				
项目研发																				

注：T 代表项目开始时点。

3、补充流动资金项目

公司将综合考虑现有资金情况、实际运营资金需求缺口，适时投入。

（六）公司的实施能力情况

公司本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面均具有良好基础，具体情况如下：

1、人员储备

公司注重人才队伍建设，持续引入高层次人才并强化自主培养体系，构筑了跨专业、多层次的人才梯队。公司通过持续完善薪酬体系和激励机制，引进优秀人才，充分激发员工积极性和创造力。截至 2025 年末，公司研发人员数量为 437 人，占公司总人数的比例超过 50%，核心技术研发团队稳定，具有较强的技术人才优势。

2、技术及专利储备

公司坚持以客户实际需求、技术发展趋势以及产业应用实践为研发导向，持续提升技术创新能力，通过对新技术的战略布局实现技术自主创新及自主可控。公司重点聚焦半导体设备领域，持续加大自主研发投入，形成了多项关键核心技术。公司注重知识产权保护，构建了完善的知识产权体系，截至 2025 年末，公司累计取得知识产权超过 500 项，其中发明专利超过 170 项。公司丰富的核心技术储备为本次募集资金投资项目的实施提供了坚实的技术基础。

3、市场储备

公司积极推进客户开发与维护，与国内头部半导体存储厂商及新型显示制造厂商建立了紧密稳定的业务合作关系。公司核心产品已应用于国内头部半导体厂商生产线，在市场上具有较强的竞争力，助力客户在降低测试成本、逐步实现供应链国产替代的同时提升生产质量，获得了客户的广泛认可。

（七）资金缺口的解决方案

本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自有或自筹资金解决。

三、项目实施的必要性和可行性

本次募集资金投资项目包括半导体存储测试设备研发及产业化智造项目、高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目以及补充流动资金。其中，半导体存储测试设备研发及产业化智造项目涉及半导体存储测试设备产业化智造项目和半导体存储测试设备技术研发项目两个子项目。本次募集资金投资项目实施的必要性和可行性分析如下：

（一）半导体存储测试设备产业化智造项目

1、项目实施必要性

（1）把握半导体存储行业发展机遇，满足下游客户对高端半导体测试设备产品的需求

DRAM 是现代信息技术和数字信息产业发展的重要基石，广泛应用于数据中心、移动设备及终端、通信、智能制造等领域。近年来，新兴技术场景持续涌现，数据总量呈现爆发式增长，广泛的数据读写与传输需求驱动全球 DRAM 市场规模快速扩大。根据 Omdia 数据，全球 DRAM 市场规模有望从 2024 年的 976 亿美元增长至 2029 年的 2,045 亿美元，年均复合增长率为 15.93%。全球 DRAM 市场需求直接拉动半导体存储测试设备需求快速增长。

同时，AI、HBM 等新兴领域推动 2.5D/3D 封装、Chiplet 等先进封装技术的快速发展，显著提升了存储芯片的集成度与结构复杂度。异构集成与垂直堆叠技术在实现性能跨越的同时，也对测试效率、良率控制提出了更严苛要求。在此背景下，下游客户对高端半导体存储测试设备的需求呈现出快速增长趋势。

公司作为国内半导体存储器测试设备行业的领先企业，已初步建成系统化全站点服务能力，产品线已覆盖半导体存储器测试领域的关键测试设备和治具，主要产品包括晶圆测试设备、老化测试及修复设备、DRAM FT 测试设备、MEMS 探针卡、老化治具板、FT 测试治具等，是国内少数实现半导体存储器测试设备全覆盖的厂商，并且部分产线已成功取代国外供应商成为相关产品主要供应商，是促进国内集成电路产业链安全稳定发展的核心力量。

本次募投项目的实施将进一步提高公司在高端半导体存储测试设备领域的产业化能力，进而更好满足我国半导体产业迭代升级对测试设备的更高要求。

(2) 拓展高端半导体存储测试设备市场布局，加速推进高端半导体存储测试设备国产化进程，支撑公司持续高质量快速发展

受益于半导体产业前沿技术的快速发展，我国半导体存储测试设备产业正处于技术水平提升的高速发展期，高端半导体存储测试设备市场将迎来广阔的市场空间。然而，目前半导体测试设备领域，尤其是高端产品市场，呈现国外龙头厂商寡头垄断的竞争格局。以半导体测试设备领域核心设备测试机为例，根据中国产业信息网及 SEMI 等公开资料数据，2024 年国外前两大测试设备厂商合计占据中国大陆测试机市场 80% 的市场份额，处于绝对的领先地位，国产化率水平相对较低，亟需进一步提升。

近年来，公司半导体测试设备业务规模及市场地位持续提升，但在经营规模

和技术能力方面与国外厂商相比仍存在一定差距，本次募投项目的实施将进一步提高高端半导体测试设备产业化能力，加快公司在高端半导体测试设备市场布局，加速高端半导体测试设备国产化进程，支撑公司高质量快速发展。

（3）依托深圳及大湾区成熟产业生态配套，加快高端半导体测试设备产业化进程

本次募投项目建设地点位于深圳市龙华区。深圳及大湾区的集成电路产业已形成全产业链生态，产业规模持续壮大。根据深圳市发改委数据显示，2025 年深圳半导体与集成电路产业规模首次突破 3,000 亿元大关，构建起自主可控、协同高效的产业生态体系，设备与材料领域国产替代成果显著，带动设备行业规模增至 356 亿元。

本次募投项目的实施将充分借助深圳及大湾区成熟产业生态配套，充分发挥高效协同供应链效应，以公司存储测试设备及相关产品为基础，不断丰富公司半导体测试设备产品类型和下游应用领域，加快产业化进程。

2、项目实施可行性

（1）广阔的下游市场空间及优质客户基础为项目实施提供稳定市场保障

半导体产业作为信息技术产业的核心基石，拥有庞大的产业规模和持续的增长潜力。近年来，随着下游人工智能、云计算及大数据等新兴领域的快速发展，我国半导体产业快速发展、晶圆产能持续扩张，为半导体设备行业带来广阔的市场空间。半导体测试设备作为半导体生产制造过程的核心设备之一，市场规模增速显著。根据 SEMI 统计及预测，2025 年半导体测试设备销售额预计达到 112 亿美元，同比增长 48.1%，2026 年至 2027 年市场规模预计达到 125 亿美元和 134 亿美元，保持持续增长态势。半导体存储测试设备作为半导体测试设备中第二大细分市场，亦迎来高速发展期。

公司深耕于半导体测试检测设备领域，坚持以市场需求为导向，与国内头部半导体存储厂商建立了紧密稳定的业务合作关系。公司核心产品已应用于国内头部半导体厂商及其供应链，在市场上具有较强的竞争力，助力客户在降低测试成本、逐步实现供应链国产替代的同时提升生产质量，获得了客户的广泛认可。依托于前期积累的优质的客户资源优势和市场口碑，公司将持续进行新客户拓展，

保障本次募投项目新建产量的有效消化。

（2）深厚的产业化经验积累和技术沉淀为项目实施提供有力产业化保障

公司持续深耕半导体测试检测设备行业，始终以实现关键设备与核心技术的自主可控为战略基石，不断加大研发投入，在半导体存储测试领域已经形成了坚实的产品和技术储备。公司的系统化全站点布局能够有效支撑下游客户关键生产环节的自主可控需求。在探针卡、老化测试及修复设备方面，公司产品已实现规模量产，出货量稳步提升；在先进封装测试领域，公司已向国内重点客户交付首台高速测试机，持续深化对前沿场景的产品覆盖。在关键技术层面，公司在高速芯片测试领域取得重要突破，测试机专用 9Gbps ASIC 芯片已通过客户验证。公司深厚的产业化经验积累和技术沉淀为本次募投项目的产业化实施提供有力保障。

（二）半导体存储测试设备技术研发项目

1、项目实施必要性

（1）紧跟行业发展趋势，依托深圳及大湾区产业集群优势，助推公司半导体存储测试设备产品升级迭代

半导体存储测试设备作为算力基础设施的关键支撑环节，面临持续增长的市场需求。同时，随着集成电路制造工艺向先进制程节点演进，以及 2.5D/3D、Chiplet 等先进封装技术的不断突破，芯片结构从平面走向立体，其复杂的互连结构与集成形态对测试设备的信号精度、多通道协同能力及系统兼容性等方面提出更高要求，驱动存储测试设备向高性能、高集成方向持续升级。

集成电路产业作为深圳及大湾区重点布局的产业集群，产业链结构日趋完善，从过去设计业“单点领跑”发展为制造、封测、设备、材料“多点支撑”的协同格局。据统计，深圳市半导体非设计业（制造、封测、设备、材料等）占比从 2020 年的 27% 攀升至 2025 年的 42%，形成了较为完备的集成电路产业链生态。

本次募投项目的实施旨在紧跟行业技术演进趋势，在深圳地区搭建起先进的软硬件研发环境，充分利用区域产业集群优势，重点推进公司半导体存储测试设备的性能提升与技术迭代，充分满足下游客户对高端测试设备日益增长的技术需

求，巩固并提升公司在半导体存储测试设备领域的市场竞争力。

（2）持续夯实技术创新能力，缩小与国际龙头厂商差距

半导体设备行业属于典型的技术密集型行业，国外龙头厂商凭借先发优势和持续高强度的研发投入已经形成一定的技术优势。公司持续深耕半导体测试检测设备行业，以实现关键设备自主可控为核心目标，围绕核心业务持续延伸、拓展基于 AI 技术发展的系统化全站点服务能力，在产品和技术方面具备较强的竞争优势，但与国外龙头厂商相比，在整体实力上仍存在一定差距。

本次募投项目将立足于公司现有的核心技术体系，践行“量产一代、在研一代、预研一代”的可持续研发节奏，持续加强研发投入，夯实并持续推动核心技术发展，以满足下游客户在半导体测试领域的多样化、复杂化需求，进一步推动我国高端半导体存储测试设备的国产化进程。

2、项目实施可行性

（1）存储测试领域丰富的技术储备与产品布局，为项目高效实施与产业化落地提供保障

在技术储备方面，公司持续致力于研发创新，以构建半导体领域的系统化测试检测设备平台为核心目标。目前，公司已积累了全栈关键技术模块，包括电子系统设计、软件算法、精密机械自动化等。各技术模块相互支撑，共同构建了适配半导体测试、晶圆检测等场景的完整技术平台，能够满足半导体测试领域的多样化需求，核心技术整体水平在国内处于领先地位，为公司在存储测试领域的研发创新提供了坚实技术支撑。

在产品布局方面，公司以 DRAM 测试设备产品线为基础纵向延伸分选机、探针台等设备构建完整测试链，同步强化 HBM 及先进封装技术研究；依托 DRAM 技术储备横向拓展至 NAND FLASH 等存储测试领域，实现产品与技术的立体化布局，为本次募投项目的实施提供方向指引。同时，依托公司在半导体存储测试设备领域成熟的产业化能力，助力研发成果的高效转化与精准落地，实现技术研发与市场需求的无缝衔接。

依托于公司前期丰富的技术积累与立体化的产品布局，公司将进一步专攻半导体存储测试关键技术，紧跟行业发展和需求变化趋势，大力推动国内半导体存

储测试设备领域的自主可控，在高端半导体测试设备领域打破海外长期垄断局面。

（2）良好的外部环境 with 长期本地化经营积累，为项目实施奠定了坚实基础

深圳作为大湾区打造集成电路产业“第三极”的核心承载地之一，在集成电路产业生态构建上，已出台诸多鼓励政策，为企业技术攻关、资金扶持、人才保障方面提供全方位支持，为半导体设备企业的创新发展提供优质的政策和产业环境。

公司成立并深耕于深圳发展，深度融入深圳半导体产业发展，积累了丰厚的本地化产业资源、专业人才储备与良好的行业口碑。公司作为国内领先的半导体测试检测设备厂商，在产业资源方面，以业务、技术协同带动产业链上下游共同发展，树立了优质的品牌形象；在人才储备方面，公司构建“引进与培养并重”的人才建设体系，打造了多领域、体系化人才梯队，核心技术团队行业经验丰富、结构稳定。与此同时，公司长期积淀的良好的社会声誉与后续经营发展中获得产业政策支持、吸引优秀人才、推动技术发展等方面形成正向循环，为本次募投项目的实施奠定了坚实基础。

（三）高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目

1、项目实施必要性

（1）前瞻性研发布局，聚焦高增长潜力的重点市场，巩固技术和产品领先性，持续夯实公司核心竞争壁垒，筑牢长期发展的护城河

近年来，以 AI 为代表的新一代前沿技术呈现加速渗透与规模化应用趋势，深刻重构全球半导体产业的竞争格局与技术演进路径。一方面，测试内容趋于复杂化，需要应对更庞大的数据流与更复杂的算法验证；另一方面，测试速度向高速化演进，以满足 HBM、算力芯片及先进封装等新兴技术的性能验证需求。AI 技术对高性能算力、高密度存力的极致诉求，叠加其对智能驾驶、云计算、边缘计算等新兴场景的应用落地，持续驱动半导体产业链上下游加速技术迭代、产品升级与制程革新，以算力芯片、HBM 为代表的高端芯片测试需求显著提升。受此影响，高端算力芯片测试设备和 HBM 测试设备等高端半导体测试设备将具有广阔的市场需求。与此同时，新一代前沿技术也为半导体测试检测设备厂商的技

术升级提出更高要求。为此，需要持续的研发投入以确保产品和技术的先进性。

此外，在人工智能与人机交互浪潮的推动下，XR 等新兴设备的崛起为微显示技术带来了产业化提速与场景多元化的双重机遇。微显示技术向高分辨率、高对比度、广视场角的持续演进，倒逼检测设备进行技术升级，要求相关企业将 AI 算法与数据分析融入检测方案，通过提供定制化的解决方案，实现技术引领与产品革新。

本次募投项目的实施旨在进行前瞻性研发布局，通过对高端半导体测试设备、微显示测试领域检测技术以及 AI 相关技术在测试检测领域落地应用等持续研发投入与布局，持续打造公司技术和产品领先性，全面深化公司技术创新水平，助力我国半导体测试检测设备行业高质量发展。

（2）自研高端测试系统的核心主控芯片，实现关键核心技术突破，确保高端半导体测试系统中 ASIC 芯片自主可控和供应链安全

半导体测试设备核心主控芯片是决定测试精度、测试效率和测试功能覆盖的关键核心部件。核心主控芯片的自主可控是构建高性能半导体测试设备核心竞争力的基石。核心主控芯片的自主可控不仅是突破高端技术壁垒、保障供应链安全的必要条件，更是降低测试成本、提升测试效率与市场竞争力的关键路径。

半导体测试设备主控芯片一般包括 ASIC 芯片和 FPGA 芯片两种类型，FPGA 芯片具有易开发特点，但性能上限相对较低，无法满足当前高端存储、算力芯片测试要求。ASIC 芯片具有高集成度、高测试速度、高测试精度、高可靠性和稳定性等特点，但芯片开发周期相对较长，具有较高的技术壁垒。国外龙头厂商的高端半导体测试设备主控芯片均采用专用 ASIC 芯片架构，以保证测试设备性能水平和稳定性。

公司以实现高端半导体测试设备及关键核心部件自主可控为目标，通过自研高端半导体测试系统的核心主控芯片，实现关键核心技术突破，是公司重要的长期战略举措。与此同时，国内主流半导体厂商积极构建本土产业链，必将成为半导体行业的关键驱动力，进一步推动高端半导体测试设备在核心环节的自主化攻坚。

本次募投项目的实施将助力公司进一步加大在高端测试机专用 ASIC 芯片领

域的研发力度,进一步提高公司高端半导体测试设备关键核心部件的技术能力和产品附加值,缩小与国外龙头厂商的技术差距,增强核心竞争力。

(3) 依托于上海及长三角区位优势,提升公司技术及产品的创新能力和国际竞争力

上海凭借其完整的产业链生态、密集的高端人才、前沿的技术策源能力以及强大的政策资本支持,为半导体企业提供了最理想的成长土壤。截至目前,上海已建成全产业链齐头并进、相互支撑的集成电路产业链体系,在芯片设计、制造、封测、设备/材料、EDA/IP 等环节培育了一批行业细分领域龙头企业。2024 年上海集成电路产业规模突破 3,900 亿元,占全国比重超 25%,同比增幅达到 20%,预计 2025 年将突破 4,600 亿元,实现 24% 的高速增长。依托于强大的产业集聚效应,上海吸引了全国约 40% 的集成电路产业人才,从业人员超 20 万,为产业持续创新提供了智力引擎和多层次的人力资源保障。

集成电路与人工智能作为上海三大先导产业的重要组成,是我国半导体产业创新发展的核心承载区和战略高地。上海作为中国集成电路产业的核心引擎,在全球半导体产业链中占据举足轻重的地位。根据世界集成电路协会(WICA)发布的《2025 年全球集成电路产业综合竞争力百强城市白皮书》显示,上海在产业基础、创新能力、发展潜力和营商环境等方面表现突出,位列全球第四、国内第一。上海在全球及中国半导体产业中具有举足轻重的地位和影响力,是半导体企业进行战略布局的重点和核心。

本次募投项目的实施将充分依托上海及长三角地区半导体产业区位优势,借力产业链协同效应、高端人才集聚优势、下游市场需求旺盛等特点,吸引优质技术人才,进一步推动公司产品技术的创新发展,夯实公司核心技术护城河。

2、项目实施可行性

(1) 国家相关产业政策的大力支持为项目实施提供了良好的政策基础

半导体产业是信息技术产业及现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业,是当前衡量一个国家或地区综合竞争力的重要标志。半导体设备作为半导体产业发展的核心驱动力,近年来国家出台一系列鼓励扶持政策,为其高质量发展提供坚实支撑。

近年来，中共中央、国家发改委、工信部等部门陆续出台《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》《国家支持发展的重大技术装备和产品目录（2021 年修订）》《产业结构调整指导目录（2024 年本）》《智能检测装备产业发展行动计划（2023—2025 年）》《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》《电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案》等产业政策，均提出强化半导体产业链发展，尤其是提高半导体测试检测设备自主供给能力。国家产业政策的大力支持为本次募投项目的实施打下坚实的政策基础。

（2）丰富的人才和技术储备为项目实施提供了坚实的技术支撑

公司持续致力于研发创新，以构建半导体领域的系统化测试检测设备平台为核心目标。目前，公司已积累了全栈关键技术模块，各技术模块相互支撑，共同构建了半导体测试检测设备领域的完整技术平台。

公司通过构建“引进与培养并重”的人才建设体系强化核心竞争力：一方面持续引进高端技术人才，精准填补关键岗位空缺；另一方面深化校企合作从源头储备新生力量；同时建立完善的考核培养机制，系统性提升员工专业能力与市场竞争力。截至 2025 年末，公司研发人员数量为 437 人，构筑起了多领域、体系化的人才梯队。凭借较强的技术实力和丰富的技术积累，截至 2025 年末，公司累计取得知识产权超过 500 项，其中发明专利超过 170 项。公司丰富的人才和技术储备为本次募投项目的实施提供强大的技术支撑。

（3）科学完善的研发体系为项目实施提供重要制度保障

完善、科学的研发体系架构及研发制度是保证研发活动正常开展，激发研发人员创造力的基础。作为创新驱动的半导体设备企业，公司始终以前瞻性技术开拓与战略规划为基点，通过自主研发、自主创新的研究模式持续拓展技术纵深与市场边界。公司重视研发体系的搭建以及相关制度的落实。目前，公司已逐步构建起了一套集研发、生产、销售于一体的创新机制。

与此同时，公司制定了较为完善的研发工作流程制度。在研发实践中，公司研发团队基于不同的项目特点，进行需求细化和技术分析，结合公司已有的研发成果，组织研发力量进行开发并实现交付，在项目完成后将技术成果模块化与固

定化，便于后续其他项目与产品研发重复使用与调取。通过市场与研发的衔接，公司研发输出符合市场需求的高质量产品，确保在技术上的可行性和经济收益上的稳定性，有效提高研发效率，降低研发风险。公司科学完善的研发体系为本次募投项目的实施提供有力的制度保障。

（四）补充流动资金

1、项目实施必要性

公司所处行业为资金密集型行业，技术研发、生产运营及相关服务都需要大量的持续资金投入。目前，公司正处于业务发展重要机遇期，在巩固既有业务优势的同时，持续聚焦新技术突破、新产品落地及新市场拓展，核心业务板块保持稳健增长。公司经营规模的持续扩大，带动原材料采购、薪酬支出、市场开拓等方面对营运资金的需求不断增加，加之存货、应收账款等经营性项目的资金占用规模相应增长，为了更好地开拓市场及支撑公司持续增长的采购需求，公司需要补充并维持一定规模的营运资金以支撑业务快速扩张。

2、项目实施可行性

公司本次发行募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第6号—轻资产、高研发投入认定标准（试行）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，具有可行性。本次发行募集资金用于补充流动资金有利于改善公司的资金状况，促进公司业绩增长，提升公司的盈利能力。

公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，形成了规范有效的内部控制环境。为规范募集资金的管理和运用，公司建立了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途以及管理与监督等方面做出了明确的规定。本次募集资金将严格按照规定存储在董事会指定的专门账户集中管理，专款专用，确保本次发行的募集资金得到规范使用。

四、募投项目效益测算的假设条件及主要计算过程

半导体存储测试设备产业化智造项目税后内部收益率为 18.22%，税后投资回收期为 8.83 年（含建设期），项目经济效益前景良好。半导体存储测试设备产业化智造项目效益预测的假设条件及主要计算过程如下：

（一）募投项目效益测算的假设条件

本着谨慎和客观的原则，公司在结合自身经营情况、项目具体情况及未来经营发展规划、市场类似项目情况等基础上，综合考虑行业发展趋势来预测本次募投项目的未来收入、成本、费用等各项指标。

本项目效益测算的基本假设包括：

- 1、国家宏观经济及产业政策无重大不利变化；
- 2、募投项目主要经营所在地区社会经济环境无重大变化；
- 3、行业未来发展趋势及市场情况无重大不利变化，行业技术路线无重大不利变动；
- 4、假定在项目预测期内下游客户需求变化趋势遵循项目预测；
- 5、无其他不可抗力及不可预见因素对公司经营造成重大不利影响。

（二）项目效益测算过程

1、营业收入测算过程

本项目收入主要来源于高端半导体存储器测试设备的销售，本项目销售收入根据产品预计销售单价乘以当年预计销量进行测算。其中，本项目产品单价测算系公司综合考虑同类产品销售价格、产品定价原则、市场同类或类似产品价格等因素进行合理估算，本项目产品销量系公司综合考虑下游市场需求、市场发展趋势、自身实际经营情况等因素进行合理估算。

2、生产成本测算过程

项目营业成本包括直接材料、直接人工、折旧摊销费用以及其他制造费用等。直接材料成本主要系综合考虑公司生产情况及本次募投项目实际情况合理估算，直接人工成本主要系综合考虑项目规模所需生产相关人员数量、公司历史薪酬水平及项目所在地区薪酬水平合理估算，折旧摊销费用依据公司会计政策和本项目资产投入情况进行合理估算，其他制造费用主要系综合考虑公司既往生产情况及本项目实际情况等因素合理估算。

3、期间费用测算过程

本项目期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用。期间费用率主要系综合考虑项目具体实际情况、历史期间数据等进行合理估算。

4、税金及附加测算过程

本项目涉及主要税种有增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等，相关税负按照税收法律法规的有关规定测算，其中增值税 13%、城市维护建设税 7%、教育费附加 3%、地方教育附加税为 2%。本项目实施主体为精智达，按照预计适用的企业所得税率 15%进行计算。

五、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性

（一）半导体存储测试设备研发及产业化智造项目

半导体存储测试设备研发及产业化智造项目涉及半导体存储测试设备产业化智造项目和半导体存储测试设备技术研发项目两个子项目。

1、项目用地及备案情况

本项目实施主体为精智达，建设用地为新增土地，建设地点为广东省深圳市龙华区观湖街道锦绣科学园 3 期。截至本募集说明书签署日，发行人已竞得该项目用地并签署了《成交确认书》（深土交成〔2026〕35 号），正在与土地出让机构签订国有土地出让合同。

本项目备案情况如下：

序号	项目名称		项目代码	备案部门	备案时间
1	半 导 体 存 储 测 试 设 备 研 发 及 产 业 化 智 造 项 目	半导体存储测试设备产业化智造项目	深龙华发改备案〔2026〕263 号	深圳市龙华区发展和改革局	2026.3.26
2		半导体存储测试设备技术研发项目	深龙华发改备案〔2026〕360 号	深圳市龙华区发展和改革局	2026.4.15

2、项目环评情况

根据《深圳市建设项目环境影响评价分类管理名录（2026 年版）》以及深圳市国寰环保科技有限公司出具的环评豁免说明，公司本次募投项目无需进

行环境影响评价。

（二）高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目

1、项目用地及备案情况

本项目实施主体为精智达，拟在租赁厂房实施，租赁地点位于上海市金桥装备小镇集创园（总部区）。截至本募集说明书签署日，精智达已与上海金桥出口加工区南区开发建设有限公司就租赁厂房事项签署租赁意向书。

本项目备案情况如下：

序号	项目名称	项目代码	备案部门	备案时间
1	高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目	上海代码： 31011557636957220261D3101001 国家代码： 2603-310115-04-03-404092	上海市浦东新区发展和改革委员会	2026.4.14

2、项目环评情况

根据上海市生态环境局关于印发《〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉上海市实施细化规定（2021年版）》的通知（沪环规[2021]11号）以及深圳市国寰环保科技发展有限公司出具的环评豁免说明，公司本次募投项目无需进行环境影响评价。

六、募集资金用于研发投入的情况

公司本次募投项目“半导体存储测试设备技术研发项目”、“高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目”部分募集资金用于研发投入，拟开展半导体测试检测设备领域核心技术、零部件、设备研发，不断提高公司在半导体存储测试设备领域及新型显示器件检测领域的技术能力，促进设备性能提升和自主创新性，进一步强化公司市场竞争力。

七、募集资金用于补充流动资金的情况

公司本次募集资金拟使用 54,290.00 万元用于补充流动资金，有助于解决公司经营发展过程中对流动资金的需求，保障公司可持续发展。

（一）补充流动资金的原因

公司所处半导体设备行业属于资本密集型行业，在生产、研发及日常运营活

动中需进行大量而持续的资金投入。公司近年来坚持内涵式发展及外延式扩张并举，积极引入创新人才，加大研发支持力度，经营业绩稳步上升。公司的创新发展需要投入大量资金，业务开展所需的采购支出、人力支出、营运支出和研发支出等营运资金将相应增加，进一步加大了公司未来对流动资金的需求。因此公司需要补充一定规模的流动资金为各项经营活动的开展提供支持，以灵活应对行业未来的发展趋势，巩固自身竞争优势。

本次通过向特定对象发行股票募集资金补充流动资金，有利于增强公司资本实力，缓解公司营运资金压力，优化财务结构，为业务拓展及整体发展规划的顺利实施提供保障，促进公司高质量、可持续发展。

（二）本次募集资金用于补充流动资金规模的合理性

综合考虑公司可自由支配资金余额、未来期间经营活动现金流量净额及各项资金需求安排等，公司未来三年总体资金缺口的具体测算过程如下：

单位：万元

项目	计算公式	金额
截至 2025 年 12 月 31 日货币资金、交易性金融资产及大额存单余额	①	116,075.06
其中：受限制的货币资金余额	②	1,008.16
前次募集资金余额	③	49,627.10
可自由支配资金余额	④=①-②-③	65,439.80
未来三年经营活动现金流量净额	⑤	28,386.12
最低现金保有量需求	⑥	71,151.92
未来三年新增最低现金保有量需求	⑦	124,088.95
未来三年预计现金分红所需金额	⑧	6,885.69
总体资金需求合计	⑨=⑥+⑦+⑧	202,126.56
总体资金缺口	⑩=⑨-④-⑤	108,300.64

公司未来三年预计经营利润积累、未来期间经营活动现金流量净额、最低现金保有量等各明细的测算过程如下：

1、可自由支配资金余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司货币资金、交易性金融资产及大额存单（含

在“一年内到期的非流动资产”及“其他非流动资产”中核算的大额存单）合计余额为 116,075.06 万元，其中使用受限的货币资金（如保证金等）1,008.16 万元，前次募集资金未使用资金为 49,627.10 万元，据此测算，公司可自由支配的资金余额为 65,439.80 万元。

2、未来三年经营活动现金流量净额

2025 年度，公司营业收入较上年同比增长 40.46%，假设未来三年公司主营业务、经营模式保持稳定，测算时按照营业收入同比增长率 40%作为未来营业收入增长率的测算依据。根据公司报告期内经营性现金流净额占营业收入的比例及公司预测的收入增速测算的未来三年营业收入，公司未来三年经营性现金流净额为 28,386.12 万元，具体测算过程如下：

单位：万元

项目	计算公式	金额
报告期内营业收入总和	①	257,975.42
报告期内经营性现金流净额	②	10,634.99
经营性现金流净额占营业收入比例	$A=②/①$	4.12%
未来三年营业收入总和	B	688,568.51
未来三年经营性现金流净额	$C=A \times B$	28,386.12

注：未来三年指 2026 年-2028 年，下同

3、最低现金保有量

最低现金保有量系公司为维持其日常营运所需要的最低货币资金。按照经营性现金流出月度覆盖法则测算最低现金保有量，报告期各期，公司经营性现金流出情况如下：

单位：万元

项目	2023 年	2024 年	2025 年
货币资金、交易性金融资产及大额存单余额	118,029.65	122,424.37	116,075.06
受限或无法使用的部分	596.81	456.84	1,008.16
前次募集资金余额	75,022.74	67,316.14	49,627.10
期末可自由支配资金余额	42,410.10	54,651.39	65,439.80
购买商品、接受劳务支付的现金	42,376.14	41,339.68	73,103.47

项目	2023 年	2024 年	2025 年
支付给职工以及为职工支付的现金	10,129.32	13,665.51	17,954.13
支付的各项税费	4,058.54	4,256.21	6,676.35
支付其他与经营活动有关的现金	8,196.71	6,817.42	8,993.94
经营活动现金流出小计	64,760.71	66,078.82	106,727.89
月均经营活动现金流出	5,396.73	5,506.57	8,893.99
覆盖月份数	7.86	9.92	7.36
覆盖月份数平均值	8.38		

结合公司日常经营收支情况等要素，按照覆盖月份平均值取整的 8 个月作为最低现金保有量测算的覆盖月份数，则截至 2025 年末，公司最低现金保有量为 71,151.92 万元。

4、未来三年新增最低现金保有量需求

公司最低现金保有量与公司经营规模高度相关。假设公司未来三年营业收入按照 40% 的速度增长，未来三年最低现金保有量在 2025 年末的基础上按同比例增长，据此计算的未来三年新增最低现金保有量为 124,088.95 万元。具体测算过程如下：

单位：万元

财务指标	计算公式	计算结果
2025 年末最低现金保有量	①	71,151.92
营业收入假设增长率	②	40.00%
2028 年末最低现金保有量	③=①*(100%+②)^3	195,240.88
未来三年新增最低现金保有量	④=③-①	124,088.95

5、未来三年预计现金分红所需金额

根据经营业绩测算以及《公司章程》涉及的分红比例的相关情况，公司预计未来三年现金分红所需金额为 6,885.69 万元。

综上所述，随着公司业务不断的发展，公司对于资金的需求亦不断增加，现阶段公司自有资金不能完全满足公司未来资金需求。本次募集资金拟用于补充流动资金的金额为 54,290.00 万元，低于公司流动资金缺口，具有合理性。

上述预测仅用于本次公司资金需求测算，并不构成公司的盈利和现金分红预测，不代表对公司未来业绩及分红安排的任何形式的保证与承诺。

八、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务

（一）本次募集资金主要投向科技创新领域的主营业务

半导体产业是信息技术产业及现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是当前衡量一个国家或地区综合竞争力的重要标志。公司持续深耕半导体测试检测设备行业，以实现关键设备自主可控为核心目标，围绕核心业务持续延伸、拓展基于 AI 技术发展的系统化全站点服务能力，公司所处行业属于高新技术产业和战略性新兴产业，公司主营业务属于科技创新领域。

本次募集资金投资项目包括半导体存储测试设备研发及产业化智造项目、高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目以及补充流动资金，有助于提高公司科技创新水平，提高公司在高端半导体测试检测设备领域的研发及产业化能力，并补充流动资金满足公司未来经营规模的持续增长和技术研发需求。因此，本次募集资金主要投向科技创新领域，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，服务于国家创新驱动发展战略及国家经济高质量发展战略。

（二）本次募投项目将促进公司科技创新水平持续提升

公司所处的半导体测试检测设备行业具有研发投入大、技术更新迭代快等特点。公司作为国内半导体测试检测设备领域领先者，已初步形成系统化全站点服务能力，是国内少数实现半导体存储器测试设备全覆盖的厂商，并于部分产线已成功取代国外供应商成为相关产品主要供应商，实现重要生产环节自主可控。为了进一步提高公司产品技术水平，持续满足下游新兴领域对高端半导体测试检测设备的技术需求，打破国外龙头厂商在国内市场的垄断局面。

公司将通过本次募投项目战略布局前沿技术领域，提高研发实力和研发效率，重点提高高端半导体测试设备和新型显示器件检测设备的产品技术能力，加快新技术成果转化和产品研发产业化，进一步提升公司技术先进性。

九、本次发行满足“两符合”和不涉及“四重大”

（一）本次发行满足“两符合”的相关规定

1、符合国家产业政策的情况

公司聚焦半导体测试及新型显示器件检测领域，致力于为行业客户提供测试检测设备及系统化解解决方案，持续推进关键工艺设备的自主可控与国产替代。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年修订），公司属于专用设备制造业（行业代码：C35）；根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“新一代信息技术产业”中的“电子核心产业”下的“新型电子元器件及设备制造”（行业代码：1.2.1）；根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》，公司主要产品属于“1 新一代信息技术产业”中的“1.3 电子核心产业”中的“1.3.2 新型显示器件”下的“新型显示设备”和“1.3.6 电子专用设备仪器”下的“半导体和集成电路测试仪器”。

本次募集资金投资项目属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》“鼓励类”项目中第二十八项“信息产业”之“4.集成电路-集成电路装备及关键零部件制造”和“8. 显示屏元器件制造及生产专用设备”，不涉及产能过剩行业或限制类、淘汰类行业、高耗能、高排放行业，符合国家产业政策要求。

2、关于募集资金投向与主业的关系

本次募集资金投资项目包括半导体存储测试设备研发及产业化智造项目、高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目及补充流动资金，有助于提高公司科技创新水平，提高公司在高端半导体测试检测设备领域的研发及产业化能力，并补充流动资金满足公司未来经营规模的持续增长和技术研发需求。因此，本次募集资金主要投向科技创新领域，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，服务于国家创新驱动发展战略及国家经济高质量发展战略。

（二）本次发行不涉及“四重大”

截至本募集说明书签署日，公司主营业务及本次发行募投项目不涉及情况特殊、复杂敏感、审慎论证的事项；公司本次发行不存在重大无先例事项，不存在影响本次发行的重大舆情，未发现公司存在相关投诉举报、信访等重大违法违规线索，本次发行满足《监管规则适用指引——发行类第 8 号》的相关规定。

综上所述，本次发行满足“两符合”，不涉及“四重大”，满足《注册管理办法》第三十条、《证券期货法律适用意见第 18 号》以及《监管规则适用指引——发行类第 8 号》的相关规定。

十、本次发行符合“理性融资、合理确定融资规模”规定

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 28,238,446 股（含本数）。

本次向特定对象发行股票的董事会，距离前次募集资金到位日超过 18 个月，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第四条相关规定。

本次募集资金投资项目包括半导体存储测试设备研发及产业化智造项目、高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目、补充流动资金，上述募投项目紧密围绕公司主营业务展开，是公司现有业务的补充和升级，顺应行业市场发展方向，符合公司业务布局及未来发展战略。

公司本次证券发行前，前次募集资金为首次公开发行股票募集资金。截至 2026 年 2 月 28 日，公司前次募集资金已基本使用完毕。

因此，本次发行符合“理性融资、合理确定融资规模”规定。

十一、公司具有轻资产、高研发投入的特点

根据《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 6 号—轻资产、高研发投入认定标准（试行）》（以下简称“《6 号指引》”）第三条及第四条关于“轻资产、高研发投入”的认定标准要求，公司具有轻资产、高研发的特点，具体情况如下：

（一）公司具有轻资产的特点

截至 2025 年末，公司固定资产、在建工程、土地使用权、使用权资产、长期待摊费用以及其他通过资本性支出形成的实物资产合计占总资产比重情况如下所示：

单位：万元

项目	金额	占总资产的比例
固定资产	4,095.23	1.75%

项目	金额	占总资产的比例
在建工程	4,285.09	1.83%
土地使用权	-	-
使用权资产	4,500.80	1.92%
长期待摊费用	5,032.98	2.15%
合计	17,914.09	7.64%

截至 2025 年末，公司固定资产、在建工程、土地使用权、使用权资产、长期待摊费用以及其他通过资本性支出形成的实物资产合计占总资产比重低于 20%，符合《6 号指引》中第三条规定的“轻资产”认定标准，即“公司最近一年末固定资产、在建工程、土地使用权、使用权资产、长期待摊费用以及其他通过资本性支出形成的实物资产合计占总资产比重不高于 20%”。

（二）公司具有高研发投入的特点

2023 年度至 2025 年度，公司研发投入分别为 7,185.00 万元、10,968.77 万元、18,311.81 万元，累计研发投入为 36,465.59 万元。截至 2025 年末，公司研发人员共 437 人，占公司当年员工总人数的比例超过 50%。

报告期内，公司研发投入及研发人员情况符合《6 号指引》第四条规定的“高研发投入”认定标准，即“最近三年累计研发投入不低于 3 亿元，且最近一年研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%”。

综上所述，公司属于具有轻资产、高研发投入特点的企业。

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划

本次向特定对象发行股票募集资金投资项目符合公司未来发展战略布局和行业发展趋势。本次发行完成后，公司主营业务保持不变，不涉及对公司现有业务及资产的整合，不会对公司的业务及资产产生重大影响。

二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化

本次发行前，截至 2025 年 12 月 31 日，张滨先生直接和间接合计控制公司 23.04%的股份，为公司实际控制人。

本次向特定对象拟发行股票总数不超过 28,238,446 股（含本数），不超过发行前股本的 30%。按照上述发行股票数量上限测算，发行后张滨先生直接和间接合计控制公司不低于 17.70%的股份。此外，报告期内，张滨先生一直在公司生产经营中担任董事长、总经理等核心职位。据此，张滨先生仍为公司的实际控制人，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况

截至本募集说明书签署日，本次向特定对象发行股票尚未确定发行对象，公司是否与发行对象或发行对象的控股股东、实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况

截至本募集说明书签署日，本次向特定对象发行股票尚未确定发行对象，公司是否与发行对象或发行对象的控股股东、实际控制人存在关联交易的情况，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

五、本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展，募集资金投向属于科技

创新领域，在项目实施的过程中，公司将持续进行研发投入，将有效提升公司的科研创新能力。

第五节 历次募集资金运用

一、最近五年内募集资金基本情况

(一) 前次募集资金金额及资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 26 日出具的《关于同意深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1170 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,350.2939 万股，每股发行价格为人民币 46.77 元，募集资金总额为人民币 109,923.25 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,266.79 万元后，募集资金净额为人民币 98,656.46 万元。

上述募集资金已于 2023 年 7 月 13 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2023]000414 号”《验资报告》。

(二) 前次募集资金存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2026 年 2 月 28 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币万元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司深圳福城支行	771877237293	4,442.10	活期
兴业银行股份有限公司深圳天安云谷支行	337110100100720095	1,165.61	活期
中国银行股份有限公司合肥蜀山支行	188774084556	-	活期
中国工商银行股份有限公司深圳生态园支行	4000134919100304096	0.08	活期
招商银行股份有限公司深圳龙华支行	755939970510636	-	注销
杭州银行股份有限公司深圳科技支行	4403040160000423059	-	注销
广东发展银行股份有限公司深圳华强北支行	9550880240694300133	-	注销
中国工商银行股份有限公司深圳生态园支行	4000134919100276705	15,360.69	活期
中国银行股份有限公司南京文德路支行	554748888476	395.87	活期

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司苏州 园区行政中心支行	526182827592	302.92	活期
合计	——	21,667.27	——

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金使用情况

截至 2026 年 2 月 28 日，前次募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金净额：98,656.46						已累计使用募集资金总额：70,257.22				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：0						2023 年度：24,417.34				
变更用途的募集资金总额比例：0						2024 年度：9,187.42				
						2025 年度：19,520.13				
						2026 年 1-2 月：17,132.33				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	新一代显示器件检测设备研发项目	新一代显示器件检测设备研发项目	19,800.00	19,800.00	8,647.37	19,800.00	19,800.00	8,647.37	-11,152.63	2028 年 2 月 (注 2)
2	新一代半导体存储器件测试设备研发项目	新一代半导体存储器件测试设备研发项目	16,200.00	16,200.00	16,266.27	16,200.00	16,200.00	16,266.27	66.27	2026 年 8 月
3	补充流动资金	补充流动资金	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	不适用
4	超募资金	超募资金用于先进封装设备研发项目	不适用	29,960.74	10,704.20	不适用	29,960.74	10,704.20	-19,256.54	2028 年 5 月
5	超募资金	超募资金用于补充流动资金	不适用	8,695.72	10,639.38	不适用	8,695.72	10,639.38	1,943.66	不适用
合计			60,000.00	98,656.46	70,257.22	60,000.00	98,656.46	70,257.22	——	——

注 1：实际投资金额为实际使用募集资金账户支付的金额，包含扣除手续费后的利息及理财收入。

注 2：公司于 2026 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑目前募集资金投资项目的实施进度等因素，同意公司将“新一代显示器件检测设备研发项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2028 年 2 月。

（二）前次募集资金变更情况

截至 2026 年 2 月 28 日，公司前次募集资金投资项目存在变更部分募投项目实施主体及实施地点的情况，未涉及募集资金的用途的变更。具体情况如下：

公司于 2025 年 2 月 18 日，召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点的议案》，公司新增控股子公司精智达集成电路的全资子公司深圳精智达半导体作为募集资金投资项目“新一代半导体存储器件测试设备研发项目”的实施主体，同时将“新一代显示器件检测设备研发项目”的实施地点由“深圳市龙华区鸿荣源鸿创科技中心”变更为“深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司 1 号 101 工业园 D 栋 1 楼东”的现有租赁厂房，并使用自有资金支付募投项目租金等费用并以募集资金等额置换。

截止 2026 年 2 月 28 日，精智达集成电路使用募集资金向控股子公司深圳精智达半导体实缴注册资本 3,000.00 万元。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》，新增控股子公司苏州精智达作为募集资金投资项目“新一代显示器件检测设备研发项目”的实施主体，同时，公司新增江苏省苏州市苏州工业园区新平街 388 号腾飞创新园作为“新一代显示器件检测设备研发项目”的实施地点；新增杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心为“新一代显示器件检测设备研发项目”的实施地点。

截止 2026 年 2 月 28 日，公司向控股子公司苏州精智达借款金额为 1,000.00 万元。

上述变更未改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（三）前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

截至 2026 年 2 月 28 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

公司于 2023 年 7 月 27 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的

议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金合计 578.16 万元（不含增值税）。独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金和银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含子公司）在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金和银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

（四）前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

新一代显示器件检测设备研发项目、新一代半导体存储器件测试设备研发项目及先进封装设备研发项目，均为公司为持续巩固核心竞争力而开展的研发投入。因上述项目无独立销售收入，故无法单独核算其直接经济效益。

补充流动资金事项，可有效缓解公司流动资金压力，为各项经营活动的顺利推进提供坚实资金保障，对公司持续健康发展具有积极意义。由于补充流动资金不直接产生营业收入，因此无法单独核算其直接经济效益。

（五）闲置募集资金的使用

公司于 2023 年 7 月 27 日召开第三届董事会第十次会议和公司第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 6 亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。

公司于 2024 年 7 月 16 日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 7 亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司上一授权期限到期日（2024 年 7 月 27 日）起 12 个月内有效。在上述授权额度及期限内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

公司于 2025 年 7 月 16 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 6 亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司上一授权期限到期日（2025 年 7 月 27 日）起 12 个月内有效。在上述授权额度及期限内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

截至 2026 年 2 月 28 日，公司募集资金进行现金管理余额为 10,860.00 万元。

（六）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2026 年 2 月 28 日，公司未使用的募集资金余额为 32,527.27 万元（包括累计收到的银行存款利息及银行理财投资收益扣除银行手续费等的净额）。公司实际募集资金净额 98,656.46 万元，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

（七）前次募集资金使用的其他情况

1、使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目

公司于 2023 年 9 月 27 日分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向控股子公司精智达集成电路提供总额不超过人民币 16,200.00 万元的借款，用于实施“新一代半导体存储器器件测试设备研发项目”，并授权精智达集成电路开立募集资金专户以进行募集资金管理。截止 2026 年 2 月 28 日，公司使用募集资金向控股子公司精智达集成电路借款金额为 16,200.00 万元。

2、使用部分超募资金投资建设新项目

公司于 2025 年 4 月 24 日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，并于 2025 年 5 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司与南京浦口经济开发区管理委员会签署《投资协议》，拟投入建设先进封装设备研发项目；同意公司使用 29,960.74 万元人民币的超募资金（含利息及现金管理收益）用于上述项目投资。截止 2026 年 2 月 28 日，公司使用募集资金向控股子公司南京精智达技术有限公司提供借款金额为 9,600.00 万元，实缴注册资本金额为 1,500.00 万元。

3、使用部分超募资金永久补充流动资金

公司于 2025 年 12 月 11 日召开第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第七次会议，于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》拟使用超募资金人民币 10,378.83 万元（截至 2025 年 11 月 30 日账户余额，含账户利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日计算利息收入等收益后的剩余金额为准）用于永久补充流动资金。公司于 2026 年 1 月 15 日完成上述补流工作，实际补充流动资金金额为 10,639.38 万元。

4、部分募投项目延期

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑目前募集资金投资项目的实施进度等因素，同意公司将“新一代显示器件检测设备研发项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2028 年 2 月。

三、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用

公司前次募集资金投资项目包括新一代显示器件检测设备研发项目、新一代半导体存储器件测试设备研发项目、先进封装设备研发项目以及补充流动资金。其中，新一代显示器件检测设备研发项目有助于公司把握新型显示器件产业高速发展机遇，发展检测设备关键技术节点，巩固在新型显示器件检测设备领域的技术和市场地位。新一代半导体存储器件测试设备研发项目有助于拓展公司半导体存储器测试设备产品线，提升测试设备产品各项性能指标，为公司未来抢占高端测试设备市场打下良好基础。先进封装设备研发项目旨在紧跟半导体先进封装行业发展趋势，进一步丰富公司产品布局，完善系统化全站点服务能力，提升核心竞争力。补充流动资金项目可提升公司营运能力，强化公司抗风险能力。

上述项目均系根据公司业务发展和技术创新需求进行的规划，项目的实施有利于公司进一步丰富产品布局、巩固市场地位，提升研发实力、增强核心竞争力。

四、会计师事务所对前次募集资金所出具的专项报告结论

2026 年 3 月 13 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至 2026

年 2 月 28 日募集资金使用情况出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核字[2026] 0011002512 号），鉴证结论如下：“我们认为，精智达董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类第 7 号》的规定，在所有重大方面公允反映了精智达公司截止 2026 年 2 月 28 日前次募集资金的使用情况。”

第六节 与本次发行相关的风险因素

一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素

（一）核心技术泄密风险

公司经过多年的技术创新和经验积累，形成相对完善的多技术领域、跨学科的核心技术体系，是公司建立市场竞争优势的重要保证。公司目前已经建立相对完整的知识产权保护体系，包含与核心技术人员签订保密和竞业协议等有效措施，但在新产品开发等需要对外合作过程中，有可能存在核心技术泄密或被他人盗用的风险。

（二）技术开发及升级迭代风险

报告期内，公司持续保持了高强度的研发投入。若在后续研发过程中关键技术未能突破、产品性能指标未达预期，新开发的产品和解决方案不能契合市场和客户需求，或者公司在研发方向上未能正确做出判断、未能及时准确地把握行业发展趋势和市场需求而进行相应的技术升级迭代，将会产生研发失败、无法及时响应下游行业的新需求、前期的研发投入难以收回的风险，会对公司的经营情况和市场竞争力造成不利影响。

（三）技术人员流失的风险

公司所处行业具有典型的知识密集型、技术密集型特点，技术人员是公司生存和发展的重要基石。如果公司无法持续提供具有竞争力的薪酬待遇、研发条件以及发展平台，公司将难以吸引更多的关键技术人才，甚至可能出现关键技术人才流失的情形，对公司产品研发造成不利影响。

（四）客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五大客户实现营业收入分别为 57,622.50 万元、59,329.04 万元和 105,127.81 万元，占当期营业收入的比重分别为 88.85%、73.87%和 93.19%，集中度相对较高，主要原因为下游客户呈现数量少、规模大的特征。若公司主要客户生产经营情况出现不利变化或公司与客户合作关系发生变化，则可

能对公司经营业绩产生不利影响。

（五）应收账款坏账风险

报告期末，公司应收账款及合同资产账面价值分别为 56,657.61 万元和 2,613.50 万元，共计占公司流动资产比例为 32.22%。如果宏观经济形势恶化或客户自身经营状况发生重大不利变化，则可能导致公司应收账款不能按期收回或无法收回的情况，进而将给公司业绩带来不利影响。

（六）存货跌价风险

报告期末，公司存货账面价值 21,001.57 万元，占流动资产的比重为 11.42%。随着公司业务规模的不断扩张，未来公司存货的规模可能进一步增长。如果未来公司下游市场需求发生变化等内外部因素导致公司产品无法正常销售，进而造成存货存在计提存货跌价准备的情况，将对公司的经营业绩产生一定不利影响。

（七）市场竞争加剧风险

公司主营业务所在市场的主要参与者不仅包括占据主导地位的国际知名龙头企业，还有部分具有一定竞争力的国内企业。如果公司不能及时将现有的市场地位和核心技术转化为更多的市场份额，则可能会在维持和拓展客户过程中面临激烈的市场竞争，从而对公司的盈利能力带来不利影响。

（八）国际宏观经济波动风险

公司聚焦半导体测试及新型显示器件检测领域，致力于为行业客户提供测试检测设备及系统解决方案。全球宏观经济波动、行业景气度及国际地缘政治等因素影响，可能引发下游市场需求波动及部分国家的贸易保护倾向，相关情况进而可能给公司生产经营产生一定不利影响。

二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素

（一）本次发行失败的风险

本次向特定对象发行方案尚需中国证监会同意注册，中国证监会能否同意注册，以及中国证监会同意注册的时间均存在不确定性；同时股票价格还受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响，存在一定的市场波动风险。因此本次发行存在发行失败的风险。

（二）募集资金不足的风险

本次发行股票数量不超过 28,238,446 股（含本数），募集资金总额不超过 285,658.00 万元（含本数），在扣除发行相关费用后拟用于半导体存储测试设备研发及产业化智造项目、高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目和补充流动资金。但若二级市场行情波动导致公司股价大幅下跌，存在筹资不足的风险，从而导致募集资金投资项目无法顺利实施。

三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素

（一）募投项目无法顺利实施的风险

本次募投项目是基于公司产品技术研发能力、行业技术发展趋势、国家产业政策等综合因素决定，募投项目经过了慎重、充分的可行性研究论证。若公司本次募投项目的技术研发方向不能顺应市场需求变化趋势、行业技术发展趋势发生重大变化、产品技术水平无法满足客户要求，公司将面临本次募投项目无法取得预期效果的风险。

（二）募投项目新增产能消化风险

公司本次募投项目的成功实施将显著提升公司半导体测试设备的研发、生产能力，可更好满足下游客户日益增长的产品需求。然而，如果未来半导体行业政策发生重大不利变化、半导体设备下游市场增长、客户拓展及销售增幅等不及预期，将对募集资金的使用和回报产生不利的影响，出现新增产能难以消化及募投项目短期内无法盈利的风险。

（三）募投项目新增折旧摊销影响公司盈利能力的风险

公司本次募投项目达产后，预计每年固定资产折旧费用、无形资产摊销费用有所增加。虽然公司对本次募投项目的经济效益经过了合理测算并具备了相应的实施能力，但如果受到宏观经济环境、产业政策、市场环境等一些不可预见因素影响或因自身技术工艺研发进度不及预期、无法及时推出匹配下游客户需求的新产品等影响公司产品市场竞争力的因素，导致募投项目未能按期达产或未达到预期收益水平，则公司将面临折旧摊销费用大幅增加、公司主要财务指标数据下滑

进而对公司盈利能力产生不利影响的风险。

（四）募投项目新增研发费用影响公司利润的风险

公司本次募集资金投资项目中存在较大规模研发费用支出。虽然公司已对本次募集资金投资项目进行了较为充分的市场调查及可行性论证，预计项目产生的效益能够充分消化新增研发费用，但若因市场环境等因素发生变化，募投项目产能消化不及预期，导致募集资金投资项目投产后盈利水平不及预期，新增研发费用可能影响公司利润，从而导致未来经营业绩存在下降的风险。

（五）即期回报被摊薄的风险

本次向特定对象发行完成后，公司股本规模和净资产规模将相应增加。由于公司本次募集资金投资项目有一定的建设期，短期内项目的效益及公司的盈利状况存在一定的不确定性，因此本次向特定对象发行后公司股东即期回报将可能因本次发行而有所摊薄。

（六）关于募集资金投资项目用地尚未取得的风险

截至本募集说明书签署日，**发行人已竞得本次募投项目半导体存储测试设备研发及产业化智造项目用地并签署了《成交确认书》（深土交成〔2026〕35号），正在与土地出让机构签订国有土地出让合同。**如公司不能及时取得相关土地使用权，将导致募集资金投资项目面临施工进度延后的风险。

第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签字：



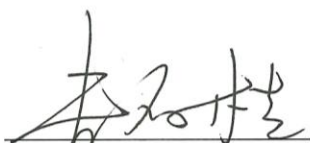
张 滨



王 磊



谢思遥



曹保桂



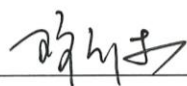
崔小兵



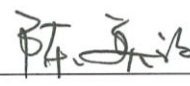
GAO FENG（高峰）



胡亮明



邓仰东



陈美汐

深圳精智达技术股份有限公司

2026年6月30日

一、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体审计委员会成员签字：



胡亮明



谢思遥



陈美汐

深圳精智达技术股份有限公司

2026年6月30日



一、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体高级管理人员签字：



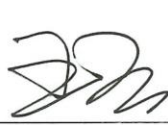
张 滨



崔小兵



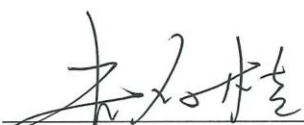
彭 娟



王 磊



李光耀



曹保桂



梁 贵

深圳精智达技术股份有限公司

2026年6月30日



二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：


张 滨

实际控制人：


张 滨

2026年 6 月 30 日

三、保荐人（主承销商）声明

（一）保荐人（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人签字：


张 旭

保荐代表人签字：


田方军


谢欣灵

法定代表人（董事长）签字：

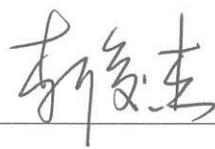

朱 健


国泰海通证券股份有限公司
2026年 6 月 30 日

（二）保荐人（主承销商）董事长和总经理声明

本人已认真阅读募集说明书的全部内容，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

总经理（总裁）签字：


李俊杰

法定代表人（董事长）签字：


朱 健



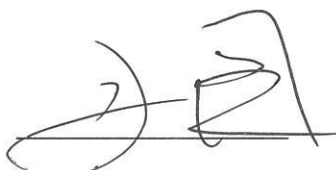
国泰海通证券股份有限公司

2026 年 6 月 30 日

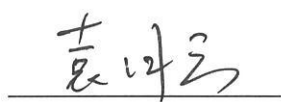
四、发行人律师声明

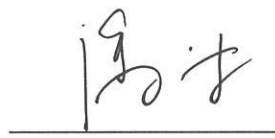
本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：


张利国

经办律师：


袁月云


潘 波

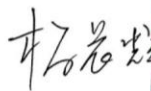


五、审计机构声明

大华特字[2026]0011001753 号

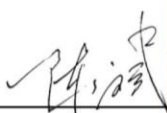
本所及签字注册会计师已阅读《深圳精智达技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“募集说明书”），确认募集说明书内容与本所出具的大华审字[2024]0011002649 号、大华审字[2025]0011000301 号和大华审字[2026]0011000311 号审计报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：




杨晨辉

签字注册会计师：


梁梁

陈斌

大华会计师事务所（特殊普通合伙）



2026 年 6 月 30 日

六、董事会声明

（一）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

本次发行可能导致股东即期回报有所下降，为了保护投资者利益，公司采取以下措施提升公司竞争力，以填补股东回报。

1、增强公司核心竞争力，扩大公司业务规模

公司将持续深耕半导体测试检测设备及系统解决方案领域，以实现关键设备自主可控为核心目标，着力构建系统化全站点服务能力。公司将把握半导体产业高速发展的市场机遇，扩大半导体测试设备产业化能力并持续加大研发投入，布局前沿技术，拓展公司产品矩阵与技术应用领域，不断增强核心竞争力，扩大公司业务规模。

2、加强募集资金管理，保证募集资金规范和有效使用

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理办法》《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》等管理制度。这些制度对公司募集资金的存放、使用、管理以及相关信息的披露进行了规范，保证了公司募集资金的存放和使用的安全，防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联方占用或挪用。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，募集资金将存放于董事会指定的专项账户中，专户专储，专款专用，切实保证募集资金的合理规范使用。

3、持续完善公司治理结构，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，确保股东能够充分行使股东权利；确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、合理的各项决策；确保董事会审计委员会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障；确保独立董事能够独立履行职责，维护公司和投资者的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。

未来公司将进一步提高经营和管理水平，完善并强化经营决策程序，全面有效地提升公司经营效率，控制公司经营风险。

4、强化投资者回报机制，保障股东利益

为进一步完善和健全持续、科学、稳定的股东分红机制和监督机制，公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，就利润分配政策事宜进行了详细规定，并制定了《深圳精智达技术股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。

本次发行完成后，公司将严格执行利润分配政策，在符合利润分配条件的情况下，积极落实对股东的利润分配，确保利润分配政策的连续性与稳定性，有效维护和增加对股东的回报水平，切实保障股东权益。

（二）相关主体对本次发行摊薄即期回报的相关承诺

1、公司的控股股东、实际控制人出具的承诺

公司控股股东、实际控制人张滨承诺如下：

“一、继续保证公司的独立性，不会越权干预公司的经营管理活动，不会侵占公司利益；

二、自本承诺函出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺；

三、若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应补偿责任。”

2、公司董事、高级管理人员出具的承诺

公司的全体董事、高级管理人员承诺如下：

“（一）忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法利益。

（二）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

（三）对本人的职务消费行为进行约束。

（四）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

（五）由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（六）如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，并给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。

在承诺函出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。”

（此页无正文，为深圳精智达技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书之《董事会声明》之盖章页）

深圳精智达技术股份有限公司董事会



2026年6月30日